

股票简称：伟测科技

股票代码：688372



# 上海伟测半导体科技股份有限公司

(Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.)

(住所：上海市浦东新区东胜路38号A区2栋2F)

## 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要

保荐机构（主承销商）

**平安证券**  
PING AN SECURITIES

(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)

二〇二五年四月

## 声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书正文内容。

### 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

### 二、本次发行的可转换公司债券的信用评级

针对本次可转债发行，本公司聘请了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司的主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA。

在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由

于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 三、本次发行不提供担保

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。

### 四、关于公司发行可转换公司债券规模

根据公司公告的《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 117,500.00 万元（含 117,500.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

在本次可转债发行之前，公司将根据公司最近一期归属于上市公司股东的净资产最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模，确保募集资金总额不超过最近一期归属于上市公司股东的净资产的 50%。

### 五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险

#### （一）公司经营业绩无法保持增长并且出现下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 49,314.43 万元、73,302.33 万元、73,652.48 万元和 42,991.52 万元，归属母公司股东的净利润分别为 13,226.12 万元、24,362.65 万元、11,799.63 万元和 1,085.66 万元。2023 年，受行业周期下行，以及股份支付费用上升及逆周期扩产导致的折旧摊销费用上升等因素的影响，公司营业收入略有增长，但是净利润下滑幅度较大。公司于 2024 年 10 月 16 日披露了《上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年 1-9 月营业收入同比上升 43.62%，归属于母公司股东的净利润同比下降 30.81%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降 20.98%。2024 年 1-9 月，公司营业收入增长明显，但归属于母公司的净利润较上年同期下滑幅度较大，主要是由于新建产能的产能利用率尚处于爬坡期导致各类固定成本上升，以及股份支付费用和研发费用较上年同期有所增加

所致。

公司营业收入及净利润的情况主要与集成电路行业是否处于景气周期、集成电路测试行业的国产化进展以及公司自身竞争力、成本费用的管控情况相关。如果未来集成电路产业景气度继续下降，行业竞争加剧，以及公司无法在技术实力、产能规模、服务品质等方面保持竞争优势，或者公司未能合理管控各类成本费用的增长，公司将面临经营业绩无法保持增长并且出现下滑的风险。

## （二）进口设备依赖的风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦加剧，从而使本公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对本公司生产经营产生不利影响。

## （三）技术更新不及时与研发失败风险

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进架构和先进封装芯片（Chiplet、Sip 等）渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

## （四）主营业务毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化比如产能利用率

下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

#### （五）本次募投项目产能消化风险

本次募投项目之“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，在无锡、南京购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”相关机台。项目建设完成后，公司产能规模，尤其是“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”产能规模将得到进一步提升。虽然本次投资项目的下游市场容量大、增速高，为项目的实施提供了市场保障，同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司本次募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本次募投项目的新增产能可能存在不能被及时消化的风险。

#### （六）本次募投项目实施后效益不及预期的风险

公司本次募投项目之“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能。公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目亦符合行业发展趋势及公司战略发展方向。根据项目可行性研究报告，“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”完全达产后年平均销售收入 33,242.40 万元，项目财务内部收益率 16.43%；“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”完全达产后年平均销售收入 31,282.85 万元，项目财务内部收益率 17.33%，项目预期效益良好。但在项目实施过程中，仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、产能消化不及预期等原因造成募投项目延期或者无法产生预期收益的风险。同时，在募投项目实施过程中，可能存在经营风险或其他不可抗力因素而导致募投项目投资周期延长、投产延迟等情况，从而产生募投项目未能实现预期效益的风险。

## 六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施

详细内容参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、报告期内相关主体承诺事项及履行情况”之“（二）本次发行所作出的重要承诺”之“1、关于对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行的承诺”。

## 七、公司股利分配政策、现金分红情况、未分配利润使用安排情况

详细内容参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、报告期内的分红情况”。

## 目 录

声 明.....	1
重大事项提示 .....	2
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转 股的风险.....	2
二、本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、本次发行不提供担保.....	3
四、关于公司发行可转换公司债券规模.....	3
五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并 特别注意以下风险.....	3
六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施.....	6
七、公司股利分配政策、现金分红情况、未分配利润使用安排情况.....	6
目 录.....	7
第一节 释 义 .....	9
一、常用词语.....	9
二、专用词语.....	11
第二节 本次发行概况 .....	14
一、发行人基本信息.....	14
二、本次发行基本情况.....	14
三、本次发行可转债的基本条款.....	22
四、本次发行的有关机构.....	32
五、发行人与本次发行有关中介机构的关系.....	33
第三节 发行人基本情况 .....	35
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况.....	35
二、控股股东和实际控制人的基本情况和上市以来的变化情况.....	35
第四节 财务会计信息与管理层分析 .....	38
一、最近三年及一期财务报表审计情况.....	38
二、财务报表.....	38
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	43

四、会计政策、会计估计及重大会计差错更正.....	44
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	46
六、财务状况分析.....	48
七、经营成果分析.....	73
八、现金流量状况分析.....	86
九、资本性支出分析.....	88
十、技术创新分析.....	89
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	91
十二、本次发行对公司的影响.....	91
<b>第五节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>93</b>
一、本次募集资金投资项目的的基本情况.....	93
二、本次募集资金投资项目的经营前景.....	93
三、与现有业务或发展战略的关系.....	94
四、本次募集资金投资项目的具体情况.....	97
五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	102
六、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程.....	103
七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	108
八、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进行、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性.....	109
<b>第六节 备查文件 .....</b>	<b>110</b>

## 第一节 释 义

本募集说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、常用词语

发行人、公司、伟测科技	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
本次发行	指	公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债	指	可转换公司债券，是指公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券，属于《证券法》规定的具有股权性质的证券
无锡伟测	指	无锡伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
南京伟测	指	南京伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
深圳伟测	指	深圳伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
天津伟测	指	天津伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
上海威矽	指	上海威矽半导体科技有限公司，公司的全资子公司
蕊测半导体	指	上海蕊测半导体科技有限公司，公司的控股股东
芯伟半导体	指	宁波芯伟半导体科技合伙企业（有限合伙），公司股东
江苏聿泉	指	江苏聿泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
苏民无锡	指	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙），公司股东
深圳南海	指	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙），公司股东
南京金浦	指	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
江苏新潮	指	江苏新潮创新投资集团有限公司，公司股东
无锡先锋	指	无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙），公司股东
苏民投君信	指	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
海思半导体	指	深圳市海思半导体有限公司
紫光展锐	指	紫光展锐（上海）科技有限公司
中兴微电子	指	深圳市中兴微电子技术有限公司
晶晨股份	指	晶晨半导体（上海）股份有限公司
中微半导	指	中微半导体（深圳）股份有限公司
中颖电子	指	中颖电子股份有限公司
比特大陆	指	Bitmain Technologies Limited，比特大陆科技控股公司
卓胜微	指	江苏卓胜微电子股份有限公司
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司
普冉股份	指	普冉半导体（上海）股份有限公司

长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
安路科技	指	上海安路信息科技股份有限公司
地平线	指	北京地平线机器人技术研发有限公司
致茂电子	指	Chroma ATE Inc., 致茂电子股份有限公司
鸿劲精密	指	Hon. Precision, Inc., 鸿劲精密股份有限公司
甬矽电子	指	甬矽电子（宁波）股份有限公司
瑞芯微	指	瑞芯微电子股份有限公司
纳芯微	指	苏州纳芯微电子股份有限公司
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
翱捷科技	指	翱捷科技股份有限公司
复旦微电	指	上海复旦微电子集团股份有限公司
季丰电子	指	上海季丰电子股份有限公司
Advantest、 爱德万	指	Advantest Corporation
Teradyne、泰瑞达	指	Teradyne (ASIA) PTE LTD
Semics	指	Semics Inc.
利扬芯片	指	广东利扬芯片测试股份有限公司
华岭股份	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司
京元电子	指	京元电子股份有限公司
矽格	指	矽格股份有限公司
欣铨	指	欣铨科技股份有限公司
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
股东大会	指	上海伟测半导体科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海伟测半导体科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保荐人、保荐机构、 主承销商、	指	平安证券股份有限公司

受托管理人、平安证券		
发行人会计师、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
《募集说明书》、募集说明书	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月
报告期各期末	指	2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

## 二、专用词语

集成电路、IC	指	Integrated Circuit，集成电路，将一定数量的电子元件（如电阻、电容、晶体管等），以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
芯片	指	集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果
硅片	指	又称裸晶圆，用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
晶圆	指	又称 Wafer、圆片，在裸晶圆上加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
晶片	指	Die，又称裸芯片、晶粒或裸片，是以半导体材料制作而成、未经封装的一小块集成电路本体，该集成电路的既定功能就是在这小小片半导体上实现
封装	指	指集成电路的封装，是半导体器件制造的最后阶段，之后将进行集成电路性能测试
封测	指	集成电路的封装与测试业务的简称
摩尔定律	指	由英特尔创始人之一戈登·摩尔于 1965 年提出的集成电路行业的一种现象，其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍
Foundry	指	在集成电路行业是指专门从事晶圆制造，接受 IC 设计公司委托制造晶圆而不自行从事芯片设计
Fabless	指	无晶圆厂芯片设计公司模式，该模式下企业只从事集成电路的设

		计和销售，而将晶圆制造、封装、测试等环节通过委外方式进行
Chipless	指	一种新的商业模式，是指一些体量巨大的电子装备公司自行设计研发芯片，芯片自用为主，以提高差异化和竞争力，芯片制造、封装、测试全部委外加工
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，即垂直整合模式，该模式下企业能够独立完成芯片设计、晶圆制造、封装测试的所有环节
晶圆测试、CP	指	Chip Probing 的缩写，也称为中测，是对晶圆级集成电路的各种性能指标和功能指标的测试
芯片成品测试、FT	指	Final Test的缩写，也称为终测，主要是完成封装后的芯片进行各种性能指标和功能指标的测试
良率	指	被测试电路经过全部测试流程后，测试结果为良品的电路数量占据全部被测试电路数量的比例。完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高，同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多
Mapping	指	晶圆结果映射图，每一个方块对应一个晶片结果
Site	指	指测试工位，每个工位每次测试一颗芯片
测试机、ATE	指	即自动测试设备 Automatic Test Equipment 的缩写
探针台、Prober	指	指将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的管脚通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接的测试设备
测试板、Load Board	指	负载板或承载板，一种用于封装后成品芯片进行测试的治具
分选机、Handler	指	根据集成电路芯片不同的性质，对其进行分级筛选的设备，将芯片逐片自动传送至测试位置的自动化设备
探针卡、Prober Card	指	一种应用于集成电路晶圆测试中的，能实现与晶圆级芯片连接的电路板，用于晶圆测试
治具、Conversion Kit	指	一种用于集成电路测试的配件
引脚	指	又称管脚，从集成电路内部电路引出与外围电路的接线
Pin	指	指探针，连接晶圆管脚和探针卡的金属针
Pad	指	指晶圆管脚，IC 引脚在晶圆上以铝垫形式引出
SoC	指	System-on-Chip 的缩写，逻辑与混合信号芯片，也称系统级芯片，是在单个芯片上集成多个具有特定功能的集成电路所形成的电子系统
Chiplet	指	一种新兴的芯片设计方法，它将一个完整的芯片分成多个较小的芯片块或芯片片，然后将这些部分组合成一个完整的芯片系统
CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心，它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
GPU	指	Graphic Processing Unit，即图像处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器
微控制单元、MCU	指	Micro Controller Unit，微控制单元，一种集成电路芯片
闪存	指	FLASH，快闪存储器，存储器芯片的一种
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的简称，是一种为专门目的而设计的集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，分为全定制和半定制两种

FPGA	指	Field Programmable Gate Array, 现场可编程门阵列, 一种半客户定制的集成电路, 在 PAL、GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物, 作为专用集成电路 (ASIC) 领域中的一种半定制电路而出现的
MEMS	指	Micro Electro Mechanical System, 微型机电系统, 指外形轮廓尺寸在毫米量级以下, 构成元件是微米量级的可控制、可运动的微型机电装置
5G	指	5th-Generation, 即第五代移动电话行动通信标准
物联网	指	The Internet of Things, 是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体, 它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
区块链	指	Blockchain, 信息技术领域的术语, 指一种综合了分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式

注: 本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 为四舍五入原因造成。

## 第二节 本次发行概况

### 一、发行人基本信息

类别	基本情况
中文名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
英文名称	Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	伟测科技
股票代码	688372
注册资本	人民币 113,834,777 元
成立日期	2016 年 5 月 6 日
上市日期	2022 年 10 月 26 日
法定代表人	骈文胜
董事会秘书	王沛
注册地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
统一社会信用代码	91310115MA1H7PY66D
办公地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 D 区 1 栋
邮政编码	201201
互联网网址	<a href="http://www.v-test.com.cn/">http://www.v-test.com.cn/</a>
电子信箱	ir@v-test.com.cn
联系电话	021-58958216
经营范围	半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造，电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。

### 二、本次发行基本情况

#### （一）本次发行的背景和目的

##### 1、本次发行的背景

（1）中国大陆集成电路测试的市场空间大、增速高，并伴随着大量的存量高端测试需求持续回流，加速了国产化进程

2013 年-2020 年，中国大陆集成电路测试的市场需求每年保持 20%以上的增速，2021 年和 2022 年，受行业周期下行的影响，增速有所下降，但仍然超过两位数。据 Gartner 咨询和法国里昂证券预测，未来几年中国大陆集成电路测

试的市场每年继续保持两位数的增长速度，2027 年中国大陆测试服务市场将达到 740 亿元。

2018 年以前，中国大陆芯片设计公司的测试订单尤其是高端芯片的测试订单主要交给中国台湾地区厂商来完成。2018 年以后，为了保障测试服务供应的自主可控，中国大陆的芯片设计公司开始大力扶持内资的测试服务供应商，并逐渐将高端测试订单向中国大陆回流，加速了国产化进程。

因此，过去几年及未来很长一段时间，在“行业新增需求增速高”、“回流的高端测试需求规模大”和“国产化进程加速”等多重因素的作用下，中国大陆测试厂商获得难得的发展机遇。

## **(2) 大量国产高端芯片和车规级芯片进入量产爆发期，配套的“高端测试”和“高可靠性测试”产能供应相对紧缺，未来需求前景广阔**

在高端芯片方面，2018 年以后，SoC 主控芯片、CPU、GPU、AI、FPGA 等各类高端芯片的发展获得国内芯片设计公司的空前重视。以华为海思、紫光展锐为代表的旗舰级消费终端 SoC 主控芯片，以华为海思、海光信息、龙芯中科、兆芯、飞腾为代表的 CPU，以景嘉微、壁仞科技、摩尔线程、燧原科技、沐曦为代表的 GPU，以华为海思、寒武纪、紫光展锐、地平线、芯驰、黑芝麻、平头哥、比特大陆等为代表的 AI 芯片或自动驾驶 AI 芯片，以及以紫光国微、复旦微电、安路科技、高云半导体为代表的 FPGA 芯片，不断经过研发迭代、持续升级，部分产品已经进入量产阶段，大部分产品在未来几年内陆续进入大规模量产爆发期。

上述高端芯片的测试需要使用爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex 等高端测试机台，这些测试机台长期被爱德万、泰瑞达两家巨头垄断，价格高，交期长，每年供给数量有限。同时，由于高端测试的技术门槛、客户门槛和资金门槛较高，而中国大陆的高端测试起步较晚，目前国内大部分测试厂商定位中低端市场，在复杂和高端产品的测试能力上相对欠缺，因此中国大陆高端测试产能相对紧缺。未来几年，随着大量国产高端芯片进入大规模量产爆发期，高端芯片测试的市场前景广阔。

在车规级芯片方面，全球车规级芯片长期被英飞凌、意法半导体、恩智浦、

瑞萨、罗姆等欧美日 IDM 厂商垄断，我国的国产化率不到个位数。随着我国新能源汽车的飞速发展和自动驾驶时代的临近，车规级芯片国产化的需求越来越迫切，2020 年以来，以地平线、芯驰科技、黑芝麻、杰发科技、合肥智芯等为代表的一大批厂商开始加大车规级芯片的开发和投入，相关产品在未来几年内陆续进入大规模量产爆发期。

不同于普通芯片的测试，车规级芯片对可靠性的要求十分苛刻，其测试过程需要使用三温探针台、三温分选机和老化测试设备，因此又被称为“高可靠性测试”。由于认证壁垒和技术壁垒较高，以及历史基础薄弱，中国大陆只有个别封测巨头及台资第三方测试巨头具备一定规模的高可靠性测试产能。2022 年以来，公司的无锡基地大力扩建车规级、工业级的高可靠性测试产能，目前已发展成为国内领先的车规级芯片测试基地。未来几年，随着国产车规级芯片陆续进入大规模量产爆发期，公司需要大力扩建车规级测试产能才能满足下游客户的旺盛需求。

**(3) 独立第三方测试在中国大陆起步晚、渗透率低，目前正处于高速发展的窗口期，而行业最大巨头京元电子出售其在中国大陆的核心业务，为内资企业提供了更多的发展空间和赶超机会**

中国台湾地区的独立第三方测试厂商经过三十多年的发展，已经充分验证了“独立第三方测试模式”的市场竞争力，并形成了一批独立第三方测试全球性巨头。中国大陆的独立第三方测试产业起步较晚，2018 年以后才进入快速发展期。从渗透率的角度来看，2022 年中国大陆最大的三家内资独立第三方测试企业占中国大陆的测试市场份额为 4.05%，而中国台湾地区三家最大的第三方测试企业占台湾地区测试市场的份额为 32%，说明中国大陆的独立第三方测试的市场渗透率还有很大提升空间。

2024 年 5 月 2 日，全球最大的独立第三方测试巨头京元电子宣布计划对外出售其在中国大陆的核心子公司京隆科技。京隆科技长期获得来自中国台湾母公司京元电子在技术、客户、人才、资本等方面的大力支持，已发展成为中国大陆最大的独立第三方测试公司，年测试收入超过 20 亿元，规模遥遥领先于其他内资测试企业。京元电子出售其在中国大陆的核心业务，将会为内资企业提供更多发展空间和赶超机会。

**(4) 集成电路行业复苏态势明显，经过 2023 年的盘整之后，公司营业收入有望在 2024 年重回高速增长轨道，产能扩张和市场份额提升仍将是公司未来几年的重要战略方向之一**

2022 年下半年以来，集成电路行业进入下行周期，经过 2023 年的低位徘徊，2024 年以来行业复苏态势明显。世界半导体贸易统计组织（WSTS）在其最新预测中表示，预计 2024 年全球半导体市场将实现 16% 的增长。

公司是第三方集成电路测试行业成长性较为突出的企业之一。2019 年-2022 年公司营业收入增长率分别为 78.38%、106.84%、205.93% 和 48.64%。2023 年受行业周期下行的影响，公司营业收入仅增长 0.48%，但是从季度数据来看，经过 2023 年一二季度的低位盘整，2023 年三四季度公司重拾增长态势，营业收入相继创出单季度历史新高。2024 年上半年公司营业收入同比增长 37.85%，从过去一年的发展趋势来看，公司营业收入有望在 2024 年重回高速增长轨道。

虽然公司已经成为第三方集成电路测试领域规模最大的内资企业之一，但是 2023 年公司销售收入仅有 7.37 亿元，仅为中国大陆集成电路测试市场规模的 2% 左右，仅相当于全球巨头京元电子销售规模的 10%，全年产能尚不能满足一家百亿收入规模级别的头部芯片设计公司一年的全部测试需求。因此，无论从市场占有率、与国际巨头的差距、公司销售占下游客户采购总额的比重等角度来看，公司仍然具有较大的发展空间。

在公司有望重回高速增长轨道，以及公司仍然具有较大的发展空间的背景下，产能扩张和市场份额提升仍将是公司未来几年的重要战略方向之一。

## **2、本次发行的目的**

**(1) 扩充“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”产能，提升公司市场竞争力，助力我国人工智能、云计算、物联网、5G、新能源电动车、自动驾驶、高端装备等下游战略新兴行业的发展**

随着全球集成电路产业贸易冲突的加剧，集成电路测试的自主可控成为行业内企业的共同诉求。本次无锡和南京两个测试基地项目的建设，主要购置“高端芯片测试”及“高可靠性测试”所需的爱德万 V93000 EXA、爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex、老化测试设备、三温探针台、

三温分选机等，大幅扩充“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的测试产能，缓解我国“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”相对紧张的局面，为我国集成电路测试的自主可控提供有力保障，最终助力我国人工智能、云计算、物联网、5G、新能源电动车、自动驾驶、高端装备等下游战略新兴行业的发展。

**(2) 为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司的行业地位，强化“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的差异化竞争优势，不断缩小与国际巨头的差距，并在部分高端设备方面首次实现同台竞技**

自 2016 年成立以来，公司经营业绩实现了高速增长，截至目前，公司已经发展成为第三方集成电路测试领域规模最大的内资企业之一。随着业务量不断上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行业具有“大者恒大”的规律，通过本次无锡和南京 2 个测试基地项目的建设，能够进一步巩固公司的行业地位，强化公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的差异化竞争优势，为公司把握国产化的历史机遇及新一轮行业上行周期的增长机会奠定基础。

本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增加公司的测试服务能力、营业收入和净利润规模，不断缩小公司与全球最大的 3 家台资巨头的差距。同时，本次募投项目购置的泰瑞达 UltraFlex Plus 等部分高端测试设备系首批引入中国大陆，使公司在部分高端设备方面首次实现与国际巨头同台竞技。

### **(3) 优化公司资本结构，提升抗风险能力**

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，助力公司可持续发展。本次可转债转股前，公司资产负债率仍可维持在合理水平，同时，中长期债务增加，债务结构优化，公司债务偿还与利息支付面临的风险较小。后续可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，资本结构得以优化，公司抗风险能力增强。

本次可转债募集资金投资项目符合国家产业政策要求和市场发展趋势，随着本次募投项目效益的实现，公司盈利水平与经营效率预计将进一步提升。

## **(二) 本次发行的证券类型**

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可

转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。

### （三）发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，发行数量为 117.50 万手（1,175.00 万张）。

### （四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

### （五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

本次可转换公司债券预计募集资金量为不超过人民币 117,500 万元（含 117,500 万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为 116,298.33 万元。

### （六）募集资金专项存储的账户

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

### （七）募集资金投向

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 117,500 万元（含本数）。扣除发行费用后的募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	20,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	27,500.00	27,500.00
合计		<b>216,240.00</b>	<b>117,500.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金

先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## （八）发行方式与发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年4月8日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

**1、向发行人原股东优先配售：**本发行公告公布的股权登记日（2025年4月8日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有普通股股东。若至股权登记日（2025年4月8日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2025年4月9日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

**2、向一般社会公众投资者网上发行：**持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。

**3、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。**

## （九）向现有股东配售的安排

### 1、发行对象

在股权登记日（2025年4月8日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

### 2、优先配售数量

原股东可优先配售的伟测转债数量为其在股权登记日（2025年4月8日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售10.322元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.010322手可转债。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次

发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和主承销商将于申购日（T 日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。

原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本 113,834,777 股，无回购到专户的库存股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 117.50 万手。

#### （十）承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）平安证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 17 日。

#### （十一）发行费用

本次发行费用总额预计为 1,201.67 万元，具体包括：

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	1,000.00
律师费用	66.04
审计及验资费用	105.00
资信评级费用	0.00
信息披露及发行手续等费用	30.64
<b>合计</b>	<b>1,201.67</b>

#### （十二）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期	交易日	发行安排
----	-----	------

2025年4月7日 周一	T-2日	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2025年4月8日 周二	T-1日	网上路演 原股东优先配售股权登记日
2025年4月9日 周三	T日	刊登《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上申购摇号中签率
2025年4月10日 周四	T+1日	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2025年4月11日 周五	T+2日	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
2025年4月14日 周一	T+3日	保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2025年4月15日 周二	T+4日	刊登《发行结果公告》

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

### （十三）本次发行证券的上市流通安排

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

### （十四）投资者持有期的限制或承诺

本次发行的证券不设持有期限限制。

## 三、本次发行可转债的基本条款

### （一）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2025年4月9日至2031年4月8日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

### （二）面值

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

### （三）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。

### （四）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 4 月 15 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 15 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031 年 4 月 8 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

### （五）评级情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的评级报告，公司的主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

### （六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

#### 1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、债券持有人的义务

(1) 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

## 3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 公司拟变更、解聘债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；

(6) 在法律法规和规范性文件规定许可的范围内，对债券持有人会议规则的修改作出决议；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(8) 公司提出债务重组方案的；

(9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(10) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《上海伟测半导体科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 债券受托管理人；

(3) 单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(4) 法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

## (七) 转股价格调整的原则及方式

### 1、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 82.15 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公

公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

## （八）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （九）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

### （十）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

$i$ ：指可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （十一）回售条款

#### 1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见本节“（十）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果

出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见本节“（十）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### （十二）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

#### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

#### 2、付息方式

(1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### 3、到期还本付息方式

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

**(十三) 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制**

#### 1、以下任一事件均构成发行人在受托管理协议下的违约事件：

(1) 公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

(2) 公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；

(3) 公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；

(4) 公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致公司偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

(5) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性

的；

(6) 公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

(7) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；

(8) 本次债券存续期内，公司违反受托管理协议项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务等义务与职责以致对公司对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续 20 个连续工作日仍未得到纠正；

(9) 公司发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

## **2、违约责任及其承担方式**

如果本协议下的公司违约事件发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知公司，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知公司，宣布取消加速清偿的决定：

(1) 向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：1) 受托管理人的合理赔偿、费用和开支；2) 所有迟付的利息；3) 所有到期应付的本金；4) 适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或

(2) 相关的公司违约事件已得到救济；或

(3) 债券持有人会议同意的其他救济措施。

公司保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 20%。

## **3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制**

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，争议各方之间应协商解决。如果协商不成，应提交深圳国际仲裁院仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

#### 四、本次发行的有关机构

##### （一）发行人

名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
法定代表人	骈文胜
住所	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
办公地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 D 区 1 栋
董事会秘书	王沛
联系电话	021-58958216
传真	无

##### （二）保荐机构、主承销商

名称	平安证券股份有限公司
法定代表人	何之江
住所	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
保荐代表人	牟军、吉丽娜
项目协办人	李姿琨
其他项目组成员	王裕明、周子杰、赵苡彤、范文卿
联系电话	0755-82404851
传真	0755-82434614

##### （三）律师事务所

名称	上海市锦天城律师事务所
负责人	沈国权
住所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
经办律师	夏瑜杰、吴迪
联系电话	021-20511000
传真	021-20511999

##### （四）审计机构

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

负责人	翁伟
住所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
经办注册会计师	顾洪涛、陈灵灵、曹俊炜、汪婷
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999

#### (五) 资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
负责人	张剑文
住所	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
经办评级师	张旻燊、王致中
联系电话	0755-82872897
传真	0755-82872897

#### (六) 申请上市的证券交易所

名称	上海证券交易所
地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号
联系电话	021-68808888
传真	021-68807813

#### (七) 登记结算公司

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
电话	021-58708888
传真	021-58899400

#### (八) 保荐人、主承销商收款银行

开户行	平安银行深圳平安银行大厦支行
户名	平安证券股份有限公司
账户号码	19014512078885

### 五、发行人与本次发行有关中介机构的关系

截至报告期末，通过股权穿透计算，保荐人平安证券间接持有发行人 0.05% 股权，保荐人控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司间接持有发行人 1.33% 股权。

除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

### 第三节 发行人基本情况

#### 一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至报告期末，公司股本总数为 113,373,910 股，其中公司前十名股东情况如下表所示：

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持有有限售条件的股份数量 (股)	持有无限售条件的股份数量 (股)	质押股份数 (股)
上海崚测半导体科技有限公司	境内非国有法人	31.00	35,142,689	35,142,689	0	0
深圳南海成长同赢股权投资基金 (有限合伙)	其他	6.11	6,925,771	0	6,925,771	0
江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	6.08	6,896,131	0	6,896,131	0
苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业 (有限合伙)	其他	5.37	6,089,871	0	6,089,871	0
苏民投君信 (上海) 产业升级与科技创新股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	5.28	5,986,327	0	5,986,327	0
宁波芯伟半导体科技合伙企业 (有限合伙)	其他	2.58	2,921,970	0	2,921,970	0
中小企业发展基金 (深圳南山有限合伙)	其他	2.48	2,812,021	0	2,812,021	0
南京金浦新潮创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2.23	2,527,090	0	2,527,090	0
顾成标	境内自然人	1.77	2,009,380	0	2,009,380	0
涂洁	境内自然人	1.55	1,757,872	0	1,757,872	0
合计		<b>64.45</b>	<b>73,069,122</b>	<b>35,142,689</b>	<b>37,926,433</b>	<b>0</b>

#### 二、控股股东和实际控制人的基本情况和上市以来的变化情况

##### (一) 控股股东及实际控制人情况

##### 1、控股股东情况

截至报告期末，崚测半导体持有公司 31.00% 的股份，为公司的控股股东，其基本信息如下：

企业名称	上海崚测半导体科技有限公司
注册资本	人民币 2,396 万元

实收资本	人民币 2,396 万元
法定代表人	骈文胜
公司成立时间	2015 年 12 月 29 日
注册地址和主要经营地	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 C303 室
经营范围	一般项目：从事半导体科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业地址	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 C303 室
主营业务及其与发行人主营业务的关系	蕊测半导体不存在实际业务经营，仅为持有发行人股份

截至报告期末，蕊测半导体的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	骈文胜	1,235	51.54
2	闻国涛	621	25.92
3	路峰	230	9.60
4	邵颖	130	5.43
5	深圳市智汇科创科技有限公司	100	4.17
6	李峰	80	3.34
合计		<b>2,396</b>	<b>100</b>

蕊测半导体最近一年主要财务数据如下：

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	2,440.38
所有者权益总额	2,438.57
营业收入	-
净利润	2,298.65

## 2、实际控制人情况

截至报告期末，骈文胜先生持有发行人控股股东蕊测半导体 51.54%的股份，并通过蕊测半导体控制发行人 31.00%的股份，为发行人的实际控制人。

公司实际控制人的简历如下：

骈文胜，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，身份证号码 12011219700512\*\*\*\*，无境外永久居留权，本科学历，1993-2000 年任摩托罗拉

（中国）电子有限公司设备经理，2000-2004 年任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司，2004-2009 年任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长，2009-2016 年任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁，2016 年 6 月至今担任公司董事长、总经理。

## （二）上市以来公司控股股东、实际控制人变化情况

自上市以来，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （三）控股股东及实际控制人所持有发行人股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至报告期末，公司控股股东及实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结或潜在纠纷的情况。

## （四）控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况

截至报告期末，公司控股股东蕊测半导体不存在对其他企业投资的情况，公司实际控制人骈文胜持有蕊测半导体 51.54%股权和公司员工持股平台芯伟半导体 30.95%的合伙份额。除此之外，公司实际控制人不存在对其他企业投资的情况。

## 第四节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量情况。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据的是 2021 年、2022 年和 2023 年公司报告期内经审计的财务会计资料及公司披露的未经审计的 2024 年 1-6 月财务报告，按合并报表口径披露。

公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部财务资料。

### 一、最近三年及一期财务报表审计情况

#### （一）审计意见类型

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了编号为天健审〔2022〕6-268 号、天健审〔2023〕6-190 号、天健审〔2024〕6-18 号的标准无保留意见审计报告。公司 2024 年 1-6 月合并及母公司财务报表未经审计。

#### （二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为当期营业收入总额的 0.5%，或金额虽未达到当期营业收入总额 0.5%但公司认为较重要的相关事项。

### 二、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	17,873.88	25,195.48	64,798.05	14,969.79
交易性金融资产	4,014.94	11,017.27	61,000.00	-
应收票据	536.46	201.28	100.00	403.00
应收账款	29,868.56	30,834.29	23,105.64	13,069.33
应收款项融资	1,604.49	914.96	-	53.55
预付款项	677.75	96.65	110.18	4.94
其他应收款	1,620.01	1,793.43	1,687.40	2,540.48

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
存货	701.23	469.26	517.92	633.66
其他流动资产	22,331.33	14,971.05	13,385.91	7,643.02
<b>流动资产合计</b>	<b>79,228.66</b>	<b>85,493.67</b>	<b>164,705.10</b>	<b>39,317.76</b>
<b>非流动资产：</b>				
其他非流动金融资产	8,500.00	8,500.00	5,000.00	-
固定资产	224,152.07	196,406.21	130,635.48	71,029.69
在建工程	68,678.58	51,413.82	11,944.24	10,962.96
使用权资产	3,468.39	4,179.45	11,932.48	27,725.25
无形资产	3,982.55	4,093.75	3,206.29	1,005.19
长期待摊费用	6,908.29	7,127.59	7,431.09	3,809.11
递延所得税资产	2,720.19	1,488.46	250.54	135.89
其他非流动资产	2,852.87	2,107.56	3,448.91	2,958.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>321,262.93</b>	<b>275,316.83</b>	<b>173,849.03</b>	<b>117,626.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>400,491.60</b>	<b>360,810.50</b>	<b>338,554.13</b>	<b>156,943.85</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	4,053.25	10,330.23	13,568.82	10,290.78
应付票据	9,300.00	3,200.00	-	-
应付账款	23,402.43	19,461.76	9,330.83	8,867.27
应付职工薪酬	1,942.96	3,090.92	2,914.57	2,416.40
应交税费	269.25	446.44	1,327.05	1,428.67
其他应付款	419.72	936.11	366.95	461.01
一年内到期的非流动负债	15,531.89	14,835.30	13,614.56	16,061.95
<b>流动负债合计</b>	<b>54,919.49</b>	<b>52,300.76</b>	<b>41,122.78</b>	<b>39,526.10</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	84,994.32	47,726.36	47,619.81	16,667.05
租赁负债	2,309.49	3,091.90	3,516.38	9,048.84
长期应付款	-	700.00	3,500.00	-
递延收益	11,561.31	11,124.72	4,675.92	1,797.70
递延所得税负债	-	-	134.48	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>98,865.12</b>	<b>62,642.97</b>	<b>59,446.58</b>	<b>27,513.59</b>
<b>负债合计</b>	<b>153,784.60</b>	<b>114,943.73</b>	<b>100,569.37</b>	<b>67,039.69</b>
<b>所有者权益：</b>				

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
实收资本（或股本）	11,337.39	11,337.39	8,721.07	6,540.80
资本公积	193,058.84	189,676.32	188,797.35	67,259.67
盈余公积	2,750.13	2,750.13	2,307.16	1,194.85
未分配利润	39,560.63	42,102.94	38,159.19	14,908.84
归属于母公司所有者权益合计	<b>246,706.99</b>	<b>245,866.77</b>	<b>237,984.77</b>	<b>89,904.16</b>
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	<b>246,706.99</b>	<b>245,866.77</b>	<b>237,984.77</b>	<b>89,904.16</b>
负债和所有者权益总计	<b>400,491.60</b>	<b>360,810.50</b>	<b>338,554.13</b>	<b>156,943.85</b>

## （二）合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	<b>42,991.52</b>	<b>73,652.48</b>	<b>73,302.33</b>	<b>49,314.43</b>
减：营业成本	30,715.20	44,955.06	37,696.78	24,430.48
税金及附加	106.57	161.47	107.79	76.73
销售费用	1,522.65	2,401.62	1,692.62	1,115.38
管理费用	3,220.03	5,246.41	3,438.75	2,179.41
研发费用	6,449.91	10,380.63	6,919.39	4,774.28
财务费用	1,487.20	3,728.75	3,393.89	1,516.22
加：其他收益	761.75	1,662.52	4,779.89	495.97
投资收益	194.08	1,401.53	90.39	23.44
公允价值变动收益	14.94	17.27	-	-
信用减值损失	-250.02	-467.33	-529.28	-521.45
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	2.94	184.93	85.05	19.57
二、营业利润	<b>213.66</b>	<b>9,577.46</b>	<b>24,479.16</b>	<b>15,239.43</b>
加：营业外收入	13.71	16.95	4.43	0.02
减：营业外支出	2.46	21.61	7.19	1.37
三、利润总额	<b>224.91</b>	<b>9,572.80</b>	<b>24,476.40</b>	<b>15,238.08</b>
减：所得税费用	-860.75	-2,226.83	113.74	2,011.96
四、净利润	<b>1,085.66</b>	<b>11,799.63</b>	<b>24,362.65</b>	<b>13,226.12</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,085.66	11,799.63	24,362.65	13,226.12

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
其中：其他	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,085.66</b>	<b>11,799.63</b>	<b>24,362.65</b>	<b>13,226.12</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,085.66	11,799.63	24,362.65	13,226.12
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
<b>七、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.10	1.04	2.71	1.61
（二）稀释每股收益	0.10	1.04	2.71	1.61

### （三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	45,106.52	68,874.27	67,292.67	45,056.50
收到的税费返还	-	4,283.57	9,138.26	820.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,360.19	8,560.48	4,847.46	2,051.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>46,466.71</b>	<b>81,718.32</b>	<b>81,278.39</b>	<b>47,928.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,696.11	8,501.97	7,110.28	7,350.34
支付给职工以及为职工支付的现金	14,826.96	23,597.31	20,493.19	11,713.96
支付的各项税费	649.77	502.12	1,301.71	1,038.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,053.16	2,861.99	2,399.63	2,593.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>26,226.01</b>	<b>35,463.38</b>	<b>31,304.81</b>	<b>22,696.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,240.70</b>	<b>46,254.94</b>	<b>49,973.58</b>	<b>25,232.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
收回投资收到的现金	63,829.96	451,807.08	32,500.00	3,869.00
取得投资收益收到的现金	194.08	1,401.53	90.39	23.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81.70	214.54	1,013.10	223.64
收到其他与投资活动有关的现金	-	518.57	3,272.30	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>64,105.74</b>	<b>453,941.72</b>	<b>36,875.79</b>	<b>4,116.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,988.63	122,156.14	80,242.49	67,394.67
投资支付的现金	58,815.09	400,307.08	103,500.00	870.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>122,803.72</b>	<b>522,463.21</b>	<b>183,742.49</b>	<b>68,264.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-58,697.98</b>	<b>-68,521.50</b>	<b>-146,866.69</b>	<b>-64,148.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	134,095.74	20,000.00
取得借款收到的现金	55,582.40	26,767.00	62,882.13	32,141.22
收到其他与筹资活动有关的现金	70.58	-	7,000.00	10,690.61
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>55,652.99</b>	<b>26,767.00</b>	<b>203,977.87</b>	<b>62,831.82</b>
偿还债务支付的现金	17,265.88	26,110.98	27,840.61	5,773.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,004.57	10,426.80	2,155.87	879.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,183.28	7,491.31	26,666.20	12,223.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>24,453.72</b>	<b>44,029.09</b>	<b>56,662.69</b>	<b>18,875.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,199.26</b>	<b>-17,262.09</b>	<b>147,315.18</b>	<b>43,956.15</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-63.58</b>	<b>-73.93</b>	<b>46.20</b>	<b>-52.58</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,321.59</b>	<b>-39,602.58</b>	<b>50,468.27</b>	<b>4,987.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,195.48	64,798.05	14,329.79	9,342.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,873.88</b>	<b>25,195.48</b>	<b>64,798.05</b>	<b>14,329.79</b>

### 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）披露有关财务信息。

#### （二）合并财务报表范围

##### 1、合并范围的确定原则

公司以控制为基础，将公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围

##### 2、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

##### 3、发行人的合并范围

截至2024年6月末，发行人纳入合并范围的公司如下：

序号	公司名称	主要经营地	持股比例	取得方式
1	无锡伟测半导体科技有限公司	江苏无锡	100%	设立
2	南京伟测半导体科技有限公司	江苏南京	100%	设立
3	上海威矽半导体科技有限公司	上海市	100%	设立
4	深圳伟测半导体科技有限公司	深圳市	100%	设立
5	天津伟测半导体科技有限公司	天津市	100%	设立

### （三）合并报表范围的变化情况

#### 1、2021 年度合并报表范围变化情况

序号	子公司名称	变动方向	变动原因
1	南京伟测半导体科技有限公司	增加	新设

#### 2、2022 年度合并报表范围变化情况

2022 年度，公司合并报表范围未发生变动。

#### 3、2023 年度合并报表范围变化情况

序号	子公司名称	变动方向	变动原因
1	深圳伟测半导体科技有限公司	增加	新设

#### 4、2024 年 1-6 月合并报表范围变化情况

序号	子公司名称	变动方向	变动原因
1	天津伟测半导体科技有限公司	增加	新设

## 四、会计政策、会计估计及重大会计差错更正

### （一）重要会计政策变更

#### 1、2021 年度变更情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
固定资产	48,666.00	-13,233.21	35,432.79
使用权资产	-	14,553.18	14,553.18
租赁负债	-	8,306.03	8,306.03
一年内到期的非流动负债	5,845.66	254.46	6,100.12

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
长期应付款	7,217.70	-7,217.70	-
未分配利润	2,605.21	-22.83	2,582.38

## 2、2022 年度变更情况说明

### (1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》对公司的影响

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### (2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》对公司的影响

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 3、2023 年度变更情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

单位：万元

受影响的报表项目	影响金额	备注
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	23.59	
递延所得税负债	-14.89	
未分配利润	38.48	
2022年12月31日利润表项目		
所得税费用	-29.92	递延所得税费用

## （二）重要会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

## （三）会计差错更正

报告期内，公司无会计差错更正事项。

## 五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

### （一）主要财务指标

主要财务指标	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	1.44	1.63	4.01	0.99
速动比率（倍）	1.43	1.63	3.99	0.98
资产负债率（母公司）	11.20%	12.45%	12.15%	27.67%
资产负债率（合并）	38.40%	31.86%	29.71%	42.72%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	21.76	21.69	20.99	10.57
应收账款周转率（次）	1.34	2.59	3.85	4.81
存货周转率（次）	52.48	91.08	65.47	49.05
息税折旧摊销前利润（万元）	17,170.88	36,390.86	43,590.01	26,097.59
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,085.66	11,799.63	24,362.65	13,226.12
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	421.77	9,067.86	20,178.70	12,768.28
研发投入占营业收入的比例	15.00%	14.09%	9.44%	9.68%
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.79	4.08	4.41	2.97
每股净现金流量（元）	-0.65	-3.49	4.45	0.59

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产

- 4、每股净资产=归属于发行人所有者权益/期末股本总额
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用（含资本化利息）+折旧+摊销
- 8、研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入
- 9、每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额
- 10、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加（减少）额 / 期末股本总额

## （二）净资产收益率与每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下表：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于发行人股东的净利润	2024 年 1-6 月	0.44%	0.10	0.10
	2023 年度	4.89%	1.04	1.04
	2022 年度	19.85%	2.71	2.71
	2021 年度	18.04%	1.61	1.61
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	2024 年 1-6 月	0.17%	0.04	0.04
	2023 年度	3.76%	0.80	0.80
	2022 年度	16.44%	2.25	2.25
	2021 年度	17.42%	1.55	1.55

注：上述财务指标的计算公式如下：

### 1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 3、稀释每股收益

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### （三）非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益如下：

单位：万元

项目	2024年 1-6月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2.94	184.93	85.05	19.58
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	537.95	1,361.49	3,620.29	494.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	209.03	1,418.80	90.39	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	23.78
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	1,156.03	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11.25	-4.66	-2.76	-0.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	3.58	-
小计	761.17	2,960.56	4,952.57	537.96
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	97.28	228.79	768.61	80.12
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	663.89	2,731.77	4,183.96	457.84

2021 年至 2023 年，公司非经常性损益金额分别为 457.84 万元、4,183.96 万元和 2,731.77 万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 3.46%、17.17%和 23.15%，对公司经营业绩影响较小。报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助和闲置资金的理财收益。

## 六、财务状况分析

### （一）资产情况

报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	79,228.66	19.78	85,493.67	23.69	164,705.10	48.65	39,317.76	25.05
非流动资产	321,262.93	80.22	275,316.83	76.31	173,849.03	51.35	117,626.09	74.95
合计	<b>400,491.60</b>	<b>100</b>	<b>360,810.50</b>	<b>100</b>	<b>338,554.13</b>	<b>100</b>	<b>156,943.85</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 156,943.85 万元、338,554.13 万元、360,810.50 万元和 400,491.60 万元，公司资产规模呈上升趋势。其中 2022 年末资产总额较 2021 年末增加 181,610.28 万元，增幅 115.72%；2023 年末资产总额较 2022 年末增加 22,256.37 万元，增幅 6.57%；2024 年 6 月末资产总额较 2023 年末增加 39,681.10 万元，增幅 11.00%。

2022 年末公司资产总额大幅增长，主要有以下两方面原因：一是公司在 2022 年度成功实现上市，共获取募集资金 123,717.95 万元；二是 2022 年度公司业务处于高速增长期间，营业收入大幅增长，实现净利润 24,362.65 万元，留存收益累计增加，资产总额随之增加。2023 年末及 2024 年 6 月末，公司资产总额的增长趋于稳定。

报告期各期末，公司流动资产分别为 39,317.76 万元、164,705.10 万元、85,493.67 万元和 79,228.66 万元，占总资产比例分别为 25.05%、48.65%、23.69% 和 19.78%，主要由货币资金、应收账款、其他应收款和其他流动资产构成；公司非流动资产分别为 117,626.09 万元、173,849.03 万元、275,316.83 万元和 321,262.93 万元，占总资产比例为 74.95%、51.35%、76.31% 和 80.22%，主要由固定资产、在建工程、使用权资产构成。报告期内，公司资产以非流动资产为主，公司资产结构稳定。总体而言，报告期内资产规模、结构及变化趋势与公司近年来业务发展情况相匹配。

## 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金结构如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款	17,873.68	100.00	24,188.38	96.00	64,798.03	100	14,329.71	95.72
其他货币资金	0.19	0.00	1,007.08	4.00	0.01	0.00	640.05	4.28
<b>合计</b>	<b>17,873.88</b>	<b>100</b>	<b>25,195.48</b>	<b>100</b>	<b>64,798.05</b>	<b>100</b>	<b>14,969.79</b>	<b>100</b>

公司货币资金主要由银行存款构成。2021 年末其他货币资金主要为使用受限的保函保证金 640.00 万元，2023 年末其他货币资金主要为存出投资款 1,007.08 万元，存出投资款为存入证券账户中尚未购买理财产品的资金，使用不受限。报告期各期末，公司货币资金余额分别为 14,969.79 万元、64,798.05 万元、25,195.48 万元及 17,873.88 万元，占流动资产的比例分别为 38.07%、39.34%、29.47%和 22.56%。2022 年末，公司货币资金的增长幅度较大，主要因为公司收到募集资金和经营积累所致。

## 2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,014.94	100	11,017.27	100	61,000.00	100	-	-
其中：理财产品	4,014.94	100	8,517.27	77.31	61,000.00	100	-	-
结构性存款	-	-	2,500.00	22.69	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,014.94</b>	<b>100</b>	<b>11,017.27</b>	<b>100</b>	<b>61,000.00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 0.00 万元、61,000.00 万元、11,017.27 万元和 4,014.94 万元，主要为结构性存款及公司购入的银行理财产品。2022 年末，公司交易性金融资产金额较大，主要系公司于 2022 年 10 月上市，首次公开发行股票募集资金到账后，公司利用闲置募集资金购买理财产品所致，相关产品风险较低、流动性较高、安全性较强、不属于收益波动大且风险较高的金融产品。

## 3、应收票据

报告期各期末，公司应收票据余额情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
银行承兑汇票	536.46	-	201.28	-	100.00	-	403.00	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>536.46</b>	-	<b>201.28</b>	-	<b>100.00</b>	-	<b>403.00</b>	-

报告期各期末，公司应收票据占流动资产的比重分别为 1.02%、0.06%、0.24%和 0.68%。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款基本情况

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30/ 2024年1-6月	2023.12.31/ 2023年度	2022.12.31/ 2022年度	2021.12.31/ 2021年度
应收账款账面余额	31,564.59	32,479.79	24,322.78	13,757.21
应收账款坏账准备	1,696.03	1,645.50	1,217.14	687.88
应收账款账面价值	29,868.56	30,834.29	23,105.64	13,069.33
营业收入	42,991.52	73,652.48	73,302.33	49,314.43
应收账款账面余额占营业收入比例	36.71%	44.10%	33.18%	27.90%

报告期各期末，随着经营规模的增长，公司应收账款账面余额相应增加，应收账款账面余额占当期营业收入比重分别为 27.90%、33.18%、44.10%和 36.71%（年化）。2021 年至 2022 年，公司应收账款余额占营业收入的比重整体保持稳定。2023 年度，公司应收账款余额占营业收入比例有所上升，主要原因系 2023 年集成电路行业已经进入下行周期，导致下游客户回款速度放缓；随着行业回暖以及整体形势的不断复苏，2024 年上半年公司应收账款余额占营业收入比例已下降至 36.71%。

##### (2) 应收账款账龄明细情况

公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。截至目前，公司客户数量 200 余家，客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM 等类型的企业，其中不乏客户 A、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股

份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、客户 B、甬矽电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名厂商。公司根据与不同客户的合作时间及客户的经营规模、资本实力等情况，对不同客户制定与业务相匹配的信用政策。目前，公司主要客户信用期为对账开票后 30 天到 90 天不等，符合行业惯例。

报告期内，公司采用按单项计提坏账准备和按组合计提坏账准备相结合的坏账准备计提方法。

公司应收账款按单项计提坏账准备的明细如下：

单位：万元

名称	2024.6.30			2023.12.31			2022.12.31			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
单项计提坏账准备	9.55	9.55	100	9.55	9.55	100	-	-	-	-	-	-
合计	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>	<b>100</b>	<b>9.55</b>	<b>9.55</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-

公司应收账款按账龄组合计提坏账准备的明细如下：

单位：万元

账龄	2024.6.30			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	29,380.60	93.11%	1,469.03	27,911.57
1-2 年	2,174.43	6.89%	217.44	1,956.99
合计	<b>31,555.04</b>	<b>100%</b>	<b>1,686.47</b>	<b>29,868.56</b>
账龄	2023.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	32,221.74	99.23%	1,611.09	30,610.65
1-2 年	248.42	0.77%	24.84	223.58
2-3 年	0.07	0.00%	0.02	0.05
合计	<b>32,470.24</b>	<b>100%</b>	<b>1,635.95</b>	<b>30,834.29</b>
账龄	2022.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	24,302.79	99.92%	1,215.14	23,087.65
1-2 年	19.99	0.08%	2.00	17.99
合计	<b>24,322.78</b>	<b>100%</b>	<b>1,217.14</b>	<b>23,105.64</b>

账龄	2021.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1年以内	13,756.86	100.00%	687.84	13,069.01
1-2年	0.35	0.00%	0.03	0.31
合计	<b>13,757.21</b>	<b>100%</b>	<b>687.88</b>	<b>13,069.33</b>

报告期各期末，公司应收账款账龄以1年以内为主，占比均在90%以上，账龄较短，应收账款安全性高，不能收回的可能性较小。

### (3) 应收账款坏账准备计提政策同行业对比

#### A、3家台资可比公司的坏账计提政策

京元电子		矽格		欣铨	
类别	计提比例	类别	计提比例	类别	计提比例
未逾期	0%	未逾期	0.001%	未披露	未披露
逾期1-90天	0%	逾期30天内	0.001%	未披露	未披露
逾期91-180天	1%	逾期31-90天内	30%	未披露	未披露
逾期181-365天	2%	逾期91-180天内	50%	未披露	未披露
逾期366天以上	5%	逾期180天以上	50%~100%	未披露	未披露

#### B、发行人与内资可比公司的坏账计提政策

类别	利扬芯片	华岭股份	发行人
1年以内	3%	3%	5%
1-2年	10%	5%	10%
2-3年	30%	10%	30%
3-4年	100%	50%	50%
4-5年	100%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

根据上述的对比，3家台资可比公司的坏账计提政策的方法与公司不一致，不具有可比性。公司各期末的应收账款均分布在1年以内和1-2年，与利扬芯片、华岭股份2家内资可比公司相比，公司的坏账计提比例更加谨慎、保守。

## (4) 应收账款前 5 名情况

单位：万元

2024.6.30			
单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 A	4,337.45	13.74%	250.17
紫光展锐（上海）科技有限公司	2,997.07	9.50%	171.34
客户 B	1,990.77	6.31%	99.54
普冉半导体（上海）股份有限公司	1,548.05	4.90%	77.40
深圳市中兴微电子技术有限公司	1,315.10	4.17%	69.93
<b>合计</b>	<b>12,188.43</b>	<b>38.61%</b>	<b>668.38</b>
2023.12.31			
单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 B	3,570.02	10.99%	178.50
紫光展锐（上海）科技有限公司	2,579.77	7.94%	128.99
深圳市中兴微电子技术有限公司	2,472.37	7.61%	123.62
客户 A	2,121.16	6.53%	106.06
合肥智芯半导体有限公司	2,028.84	6.25%	101.44
<b>合计</b>	<b>12,772.17</b>	<b>39.32%</b>	<b>638.61</b>
2022.12.31			
单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 A	3,862.86	15.88%	193.14
Bitmain Technologies Limited（比特大陆）	2,837.05	11.66%	141.85
晶晨半导体（上海）股份有限公司	2,130.64	8.76%	106.53
客户 B	1,360.71	5.59%	68.041
紫光展锐（上海）科技有限公司	1,332.00	5.48%	66.60
<b>合计</b>	<b>11,523.26</b>	<b>47.37%</b>	<b>576.16</b>
2021.12.31			
单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 A	2,447.65	17.79%	122.38
晶晨半导体（上海）股份有限公司	2,133.39	15.51%	106.67
紫光展锐（上海）科技有限公司	1,340.36	9.74%	67.02
Bitmain Technologies Limited（比特大陆）	781.09	5.68%	39.05

甬矽电子（宁波）股份有限公司	602.29	4.38%	30.11
<b>合计</b>	<b>7,304.78</b>	<b>53.10%</b>	<b>365.24</b>

公司应收账款前五大客户基本都是行业内的知名客户，以上市公司或者行业巨头为主，客户的资信实力较强，公司与其建立了长期稳定的合作关系，应收账款质量较好，无法收回的风险较小。

## 5、应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应收款项融资	1,604.49	914.96	-	53.55
<b>合计</b>	<b>1,604.49</b>	<b>914.96</b>	<b>-</b>	<b>53.55</b>

报告期各期末，公司应收款项融资占流动资产的比重分别为 0.14%、0.00%、1.07%和 2.03%，主要为信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票，2023 年及 2024 年上半年使用银行承兑汇票向公司支付的客户增加，导致应收款项融资金额有所增长。

## 6、预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 4.94 万元、110.18 万元、96.65 万元和 677.75 万元。公司预付款项主要为账龄在一年以内的尚未与供应商办理结算的预付采购款。

报告期各期末，预付款项账龄情况如下：

单位：万元，%

账龄	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	675.21	99.62	94.63	97.91	110.18	100	4.56	92.30
1-2 年	2.54	0.38	2.02	2.09	-	-	0.38	7.70
<b>合计</b>	<b>677.75</b>	<b>100</b>	<b>96.65</b>	<b>100</b>	<b>110.18</b>	<b>100</b>	<b>4.94</b>	<b>100</b>

## 7、其他应收款

报告期内，公司其他应收款主要包括融资租赁的押金保证金、备用金等，其他应收款构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
押金保证金	1,380.43	65.30	1,356.48	64.97	1,942.18	99.97	2,200.55	78.71
应收暂付款	-	-	-	-	-	-	594.69	21.27
备用金	1.04	0.05	1.02	0.05	0.61	0.03	0.61	0.02
员工购房借款	487.20	23.05	387.20	18.55	-	-	-	-
设备处置款	245.20	11.60	343.09	16.43	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,113.86</b>	<b>100</b>	<b>2,087.78</b>	<b>100</b>	<b>1,942.79</b>	<b>100</b>	<b>2,795.85</b>	<b>100</b>

报告期内，公司其他应收款计提坏账准备的情况如下：

## (1) 类别明细情况

单位：万元

种类	2024.6.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备	8.00	8.00	-	8.00	8.00	-
按组合计提坏账准备	2,105.86	485.85	1,620.01	2,079.78	286.35	1,793.43
<b>合计</b>	<b>2,113.86</b>	<b>493.85</b>	<b>1,620.01</b>	<b>2,087.78</b>	<b>294.35</b>	<b>1,793.43</b>

(续)

种类	2022.12.31			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,942.79	255.39	1,687.40	2,795.85	255.37	2,540.48
<b>合计</b>	<b>1,942.79</b>	<b>255.39</b>	<b>1,687.40</b>	<b>2,795.85</b>	<b>255.37</b>	<b>2,540.48</b>

## (2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

单位：万元

账龄	坏账计提比例	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	5%	639.31	31.97	860.48	43.02	846.31	42.32	1,452.45	72.62
1-2年	10%	317.93	31.79	818.31	81.83	644.40	64.44	1,101.36	110.14
2-3年	30%	862.72	258.81	267.05	80.12	387.03	116.11	242.04	72.61

账龄	坏账计提比例	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
3-4年	50%	239.17	119.58	85.91	42.96	65.05	32.52	-	-
4-5年	80%	15.21	12.17	48.03	38.43	-	-	-	-
5年以上	100%	31.52	31.52	-	-	-	-	-	-
合计	-	<b>2,105.86</b>	<b>485.85</b>	<b>2,079.78</b>	<b>286.35</b>	<b>1,942.79</b>	<b>255.39</b>	<b>2,795.85</b>	<b>255.37</b>

## 8、存货

报告期各期末，公司存货具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
周转材料	701.23	100	469.26	100	517.92	100	633.66	100

公司的主营业务为集成电路测试服务，不生产具体的产品。因此，报告期内公司的存货均为开展测试服务所需的周转材料，其占流动资产比重较小，对公司财务状况影响较小。由于存货主要是周转材料，所以不存在存货积压、销售不畅等情况，报告期内存货不存在跌价的情形。

## 9、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
待抵扣进项税	19,973.02	14,618.34	7,455.56	7,510.29
IPO申报费用	-	-	-	132.74
理财产品	2,002.40	-	5,000.00	-
预缴所得税	355.91	352.71	930.35	-
合计	<b>22,331.33</b>	<b>14,971.05</b>	<b>13,385.91</b>	<b>7,643.02</b>

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 7,643.02 万元、13,385.91 万元、14,971.05 万元和 22,331.33 万元，主要是增值税待抵扣进项税。待抵扣进项税主要系公司购买测试设备等生产设备的增值税进项税额。

## 10、其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
江苏泰治股权投资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
芯知微股权投资	500.00	500.00	-	-
上海信邀股权投资	3,000.00	3,000.00	-	-
合计	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	-

截至 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产余额为 8,500.00 万元，其中公司投资江苏泰治科技股份有限公司 5,000.00 万元，为对产业链上游供应商的投资，公司投资芯知微电子（苏州）有限公司 500.00 万元，为对产业链下游客户的投资，两者均不属于财务性投资。

公司已投资上海信邀创业投资中心（有限合伙）并实缴出资额 3,000.00 万元，属于财务性投资，占期末合并报表归属于母公司净资产 246,706.99 万元的比例为 1.22%，比例较低。除此之外，公司最近一期末不存在其他财务性投资的情形。

## 11、固定资产

### （1）固定资产构成

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
房屋及建筑物	1,670.18	0.75	1,719.06	0.88	1,816.83	1.39	1,781.43	2.51
专用设备	222,116.46	99.09	194,454.91	99.01	128,748.26	98.56	69,141.88	97.34
办公设备	187.72	0.08	222.08	0.11	70.39	0.05	106.37	0.15
其他	177.71	0.08	10.16	0.01	-	-	-	-
合计	<b>224,152.07</b>	<b>100</b>	<b>196,406.21</b>	<b>100</b>	<b>130,635.48</b>	<b>100</b>	<b>71,029.69</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 71,029.69 万元、130,635.48 万元、196,406.21 万元和 224,152.07 万元，占非流动资产的比例分别为 60.39%、75.14%、71.34%和 69.77%。报告期内公司固定资产主要为公司生产经营所必须的资产，包括各类测试机、探针台和分选机等设备，固定资产规模随公司 IPO 募投项目的逐步落地、产能的增加整体呈上升趋势。

## (2) 固定资产折旧情况

报告期各期末，公司固定资产原值、折旧情况、账面价值和成新率情况如下：

单位：万元

2024.6.30					
类别	期末原值	当期计提折旧	累计折旧	账面价值	账面成新率(%)
房屋及建筑物	1,949.92	48.88	279.74	1,670.18	85.65
专用设备	283,021.62	14,126.47	60,905.16	222,116.46	78.48
办公设备	404.80	34.37	217.08	187.72	46.37
其他	182.06	3.75	4.35	177.71	97.61
<b>合计</b>	<b>285,558.39</b>	<b>14,213.46</b>	<b>61,406.33</b>	<b>224,152.07</b>	<b>78.50</b>
2023.12.31					
类别	期末原值	当期计提折旧	累计折旧	账面价值	账面成新率(%)
房屋及建筑物	1,949.92	97.77	230.86	1,719.06	88.16
专用设备	242,358.77	20,958.61	47,903.86	194,454.91	80.23
办公设备	404.80	48.26	182.72	222.08	54.86
运输工具	10.76	0.60	0.60	10.16	94.42
<b>合计</b>	<b>244,724.25</b>	<b>22,986.39</b>	<b>48,318.04</b>	<b>196,406.21</b>	<b>80.26</b>
2022.12.31					
类别	期末原值	当期计提折旧	累计折旧	账面价值	账面成新率(%)
房屋及建筑物	1,949.92	95.19	133.09	1,816.83	93.17
专用设备	153,963.01	11,123.59	25,214.76	128,748.26	83.62
办公设备	204.85	35.98	134.46	70.39	34.36
<b>合计</b>	<b>156,117.78</b>	<b>11,254.76</b>	<b>25,482.30</b>	<b>130,635.48</b>	<b>83.68</b>
2021.12.31					
类别	期末原值	当期计提折旧	累计折旧	账面价值	账面成新率(%)
房屋及建筑物	1,819.34	37.90	37.90	1,781.43	97.92
专用设备	79,827.65	5,909.86	10,685.77	69,141.88	86.61
办公设备	204.85	21.06	98.47	106.37	51.93
<b>合计</b>	<b>81,851.84</b>	<b>5,968.82</b>	<b>10,822.15</b>	<b>71,029.69</b>	<b>86.78</b>

报告期各期末，公司专用设备账面价值分别为 69,141.88 万元、128,748.26 万元、194,454.91 万元和 222,116.46 万元，占固定资产账面价值的比例分别为

97.34%、98.56%、99.01%和 99.09%。公司固定资产主要为测试设备，自公司成立以来持续购入，账面成新率较高。

## 12、使用权资产

单位：万元

2024.6.30			
类别	期末原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	6,671.70	3,203.31	3,468.39
专用设备	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,671.70</b>	<b>3,203.31</b>	<b>3,468.39</b>
2023.12.31			
类别	期末原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	6,761.22	2,581.77	4,179.45
专用设备	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,761.22</b>	<b>2,581.77</b>	<b>4,179.45</b>
2022.12.31			
类别	期末原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	5,193.46	1,551.83	3,641.62
专用设备	9,906.38	1,615.53	8,290.86
<b>合计</b>	<b>15,099.84</b>	<b>3,167.36</b>	<b>11,932.48</b>
2021.12.31			
类别	期末原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	4,938.17	664.46	4,273.71
专用设备	26,082.24	2,630.71	23,451.53
<b>合计</b>	<b>31,020.41</b>	<b>3,295.17</b>	<b>27,725.25</b>

从 2021 年 1 月 1 日起，公司执行财政部修订后的《企业会计准则 21 号—租赁》，根据新租赁准则及相关衔接规定，公司新增租赁的厂房以及新增的融资租赁设备计入“使用权资产”科目核算。报告期内公司使用权资产的账面价值为 27,725.25 万元、11,932.48 万元和、4,179.45 万元和 3,468.39 万元，主要为厂房租赁及融资租赁专用设备。

## 13、在建工程

报告期各期末，公司在建工程的构成情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
测试设备	40,573.80	31,743.58	10,854.65	7,916.31
厂务工程	27,558.99	19,219.35	549.87	2,909.72
其他	545.79	450.89	539.72	136.93
<b>合计</b>	<b>68,678.58</b>	<b>51,413.82</b>	<b>11,944.24</b>	<b>10,962.96</b>

报告期末，公司在建工程分别为 10,962.96 万元、11,944.24 万元、51,413.82 万元和 68,678.58 万元，占非流动资产的比例分别为 9.32%、6.87%、18.67%和 21.38%。在建工程中厂务工程主要是厂房配套设施。

2024 年 1-6 月公司在建工程增减变动情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
测试设备	31,743.58	50,687.59	41,857.37	-	40,573.80
厂务工程	19,219.35	8,577.60	-	237.95	27,558.99
其他	450.89	272.68	171.30	6.48	545.79
<b>合计</b>	<b>51,413.82</b>	<b>59,537.87</b>	<b>42,028.67</b>	<b>244.43</b>	<b>68,678.58</b>

2023 年公司在建工程增减变动情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
测试设备	10,854.65	98,828.04	77,939.11	-	31,743.58
厂务工程	549.87	19,132.65	-	463.17	19,219.35
其他	539.72	1,190.50	1,167.77	111.56	450.89
<b>合计</b>	<b>11,944.24</b>	<b>119,151.18</b>	<b>79,106.88</b>	<b>574.73</b>	<b>51,413.82</b>

2022 年公司在建工程增减变动情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
测试设备	7,916.31	61,187.94	58,249.60	0.00	10,854.65
厂务工程	2,909.72	2,190.81	130.58	4,420.08	549.87
其他	136.93	1,224.77	821.98	0.00	539.72
<b>合计</b>	<b>10,962.96</b>	<b>64,603.53</b>	<b>59,202.16</b>	<b>4,420.08</b>	<b>11,944.24</b>

2021 年公司在建工程增减变动情况如下：

单位：万元

项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
测试设备	7,886.13	50,249.97	37,993.41	12,226.38	7,916.31
厂务工程	1,477.87	3,652.95	-	2,221.10	2,909.72
软件使用权	4.34	108.36	-	112.71	-
其他	212.68	1,801.89	1,877.63	-	136.93
<b>合计</b>	<b>9,581.01</b>	<b>55,813.18</b>	<b>39,871.04</b>	<b>14,560.19</b>	<b>10,962.96</b>

报告期内，公司在建工程中的测试设备安装调试完成后转为固定资产的金额分别为 37,993.41 万元、58,249.60 万元、77,939.11 万元和 41,857.37 万元。厂务工程竣工后转为长期待摊费用的金额分别为 2,221.10 万元、4,420.08 万元、463.17 万元和 237.95 万元。

#### 14、无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
<b>软件使用权</b>				
原值	737.19	730.56	708.96	354.56
累计摊销	460.31	393.24	253.46	134.97
减值准备	-	-	-	-
账面价值	276.88	337.32	455.51	219.59
<b>土地使用权</b>				
原值	3,887.33	3,887.33	2,789.36	795.96
累计摊销	181.67	130.90	38.58	10.36
减值准备	-	-	-	-
账面价值	3,705.66	3,756.43	2,750.78	785.60
<b>合计</b>				
原值	4,624.53	4,617.89	3,498.32	1,150.52
累计摊销	641.98	524.14	292.03	145.33
减值准备	-	-	-	-
账面价值	3,982.55	4,093.75	3,206.29	1,005.19

公司无形资产为软件使用权及土地使用权，软件使用权主要为 M7000 测试系统软件、进销存管理系统软件、AMC Mapping 分析软件等生产、研发和办公

支持软件。土地使用权主要为无锡伟测及南京伟测为新建厂房所购置的土地。

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 1,005.19 万元、3,206.29 万元、4,093.75 万元和 3,982.55 万元，占各期末非流动资产比例分别为 0.85%、1.84%、1.49%和 1.24%。报告期内，无形资产不存在减值情况。

报告期内，不存在开发支出资本化形成的无形资产；报告期各期末，公司无形资产使用情况良好，未出现减值迹象。

## 15、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
厂房配套工程	6,462.66	93.55	6,631.39	93.04	6,886.31	92.67	3,399.62	89.25
专利使用费	58.34	0.84	74.25	1.04	106.07	1.43	137.89	3.62
消防工程	274.29	3.97	303.42	4.26	342.99	4.62	164.50	4.32
企业邮箱服务费	-	-	-	-	-	-	0.34	0.01
电力设施费用	113.00	1.64	118.53	1.66	95.72	1.29	106.76	2.80
<b>合计</b>	<b>6,908.29</b>	<b>100</b>	<b>7,127.59</b>	<b>100</b>	<b>7,431.09</b>	<b>100</b>	<b>3,809.11</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司长期待摊费用的金额为 3,809.11 万元、7,431.09 万元、7,127.59 万元和 6,908.29 万元，占非流动资产的比例分别为 3.24%、4.27%、2.59%和 2.15%。长期待摊费用的增加主要是厂房配套工程和消防工程增加所致，厂务工程主要包括厂房的总装工程、办公室装修、电力工程及后续升级改造等。

## 16、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下表所述：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
预付设备工程款	2,733.79	1,889.10	3,448.91	2,958.01
预付软件购置款	119.07	218.46	-	-
<b>合计</b>	<b>2,852.87</b>	<b>2,107.56</b>	<b>3,448.91</b>	<b>2,958.01</b>

报告期内，公司的其他非流动资产主要为预付设备工程款。

## （二）负债情况

报告期各期末，公司负债具体构成如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	54,919.49	35.71	52,300.76	45.50	41,122.78	40.88	39,526.10	58.96
非流动负债	98,865.12	64.29	62,642.97	54.50	59,446.58	59.12	27,513.59	41.04
合计	<b>153,784.60</b>	<b>100</b>	<b>114,943.73</b>	<b>100</b>	<b>100,569.37</b>	<b>100</b>	<b>67,039.69</b>	<b>100</b>

### 1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款具体构成如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用借款	3,000.00	74.01	8,950.00	86.64	7,700.00	56.75	4,000.00	38.87
保证借款	1,050.00	25.91	1,372.00	13.28	5,764.60	42.48	6,280.00	61.03
借款利息	3.25	0.08	8.23	0.08	104.22	0.77	10.78	0.10
合计	<b>4,053.25</b>	<b>100</b>	<b>10,330.23</b>	<b>100</b>	<b>13,568.82</b>	<b>100</b>	<b>10,290.78</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 10,290.78 万元、13,568.82 万元、10,330.23 万元和 4,053.25 万元。报告期内，公司积极扩张集成电路测试产能，银行借款是公司重要的融资方式之一，公司资信情况良好，与多家商业银行保持良好的长期合作关系，随着公司资信实力的上升，报告期内信用借款占比不断上升，保证借款占比不断下降，整体短期借款余额稳定。

### 2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据具体构成如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用证	2,000.00	21.51	2,000.00	62.50	-	-	-	-
银行承兑汇票	7,300.00	78.49	1,200.00	37.50	-	-	-	-
合计	<b>9,300.00</b>	<b>100</b>	<b>3,200.00</b>	<b>100</b>	-	-	-	-

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 0 万元、0 万元、3,200 万元和

9,300 万元，主要为信用证和银行承兑汇票。

2023 年末，应付票据较 2022 年末增加 3,200 万元，2024 年 6 月末，应付票据较 2023 年末增加 6,100 万元，主要原因系公司业务规模增长，考虑运营资金管理等因素，使用信用证、银行承兑汇票多种融资方式所致。

### 3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款具体构成如下：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
设备采购款	17,615.45	75.27	11,756.18	60.41	6,924.17	74.21	7,348.56	82.87
安装工程款	2,806.48	11.99	5,342.56	27.45	353.98	3.79	4.00	0.05
材料采购款	2,830.88	12.10	2,026.12	10.41	1,673.62	17.94	1,294.83	14.60
设备租赁款	102.72	0.44	106.42	0.55	309.02	3.31	181.86	2.05
其他	46.91	0.20	230.47	1.18	70.04	0.75	38.02	0.43
<b>合计</b>	<b>23,402.43</b>	<b>100</b>	<b>19,461.76</b>	<b>100</b>	<b>9,330.83</b>	<b>100</b>	<b>8,867.27</b>	<b>100</b>

应付账款主要是购置生产设备的应付设备采购款、安装工程款及应付供应商的材料款。报告期各期末，公司应付账款的规模呈扩张趋势，主要因公司持续购买设备扩大产能和本次募投项目南京测试基地厂房建设陆续投入。

### 4、应付职工薪酬

报告期各期，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
短期薪酬	1,836.27	2,982.54	2,747.41	2,347.72
离职后福利-设定提存计划	106.69	108.38	167.16	68.68
<b>合计</b>	<b>1,942.96</b>	<b>3,090.92</b>	<b>2,914.57</b>	<b>2,416.40</b>

公司职工薪酬主要包括员工工资、奖金、社会保险费、住房公积金、津贴和补贴等。报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 2,416.40 万元、2,914.57 万元、3,090.92 万元和 1,942.96 万元。报告期各期末，公司员工人数分别为 927 人、1,251 人、1,410 人和 1,600 人，公司应付职工薪酬持续增长，主要系员工人数随着业务规模扩大不断增长所致。

## 5、应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
企业所得税	184.55	354.28	1,208.72	1,388.29
代扣代缴个人所得税	43.38	51.32	58.61	21.52
印花税	27.47	26.32	52.86	11.90
土地使用税	8.35	9.03	1.36	1.36
房产税	5.49	5.49	5.49	5.60
<b>合计</b>	<b>269.25</b>	<b>446.44</b>	<b>1,327.05</b>	<b>1,428.67</b>

报告期各期末，公司应交税费分别为 1,428.67 万元、1,327.05 万元、446.44 万元和 269.25 万元，主要为应交企业所得税。2021 年至 2022 年，子公司无锡伟测及南京伟测相继申请集成电路两免三减半税收优惠，由于当期末尚未获取批文，无锡伟测及南京伟测基于谨慎性原则，按照 25% 的税率预提了企业所得税，使得 2021 及 2022 年末公司应交企业所得税大幅增长。报告期内，由于公司采购设备的增值税进项金额一直大于开展测试业务的增值税销项金额，因此报告期内没有缴纳增值税。

## 6、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款具体构成如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
押金保证金	80.00	710.00	100.00	-
费用款	339.72	226.11	266.95	461.01
<b>合计</b>	<b>419.72</b>	<b>936.11</b>	<b>366.95</b>	<b>461.01</b>

报告期各期末，公司其他应付款分别为 461.01 万元、366.95 万元、936.11 万元和 419.72 万元，主要是押金保证金和应付员工报销款等，随着公司继续落实成本控制管理，精细化控制各项成本费用支出，各年度费用款趋于更加合理。

## 7、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债明细情况如下：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
1年内到期的长期借款	12,152.68	10,890.19	7,250.39	5,607.02
1年内到期的长期应付款	2,100.00	2,800.00	2,800.00	-
1年内到期的租赁负债	1,279.21	1,145.11	3,564.17	10,454.93
合计	<b>15,531.89</b>	<b>14,835.30</b>	<b>13,614.56</b>	<b>16,061.95</b>

报告期末，公司的一年内到期的非流动负债分别为 16,061.95 万元、13,614.56 万元、14,835.30 万元和 15,531.89 万元，占流动负债的比例分别为 40.64%、33.11%、28.37%和 28.28%。公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款。

## 8、长期借款

报告期内，公司长期借款的构成情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2024.6.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
保证及抵押借款	77,454.75	91.13	42,644.25	89.35	32,380.71	68.00	16,638.34	99.83
保证借款	4,475.43	5.27	5,034.87	10.55	15,180.25	31.88	-	-
信用借款	2,980.00	3.51	-	-	-	-	-	-
借款利息	84.14	0.10	47.24	0.10	58.85	0.12	28.71	0.17
合计	<b>84,994.32</b>	<b>100</b>	<b>47,726.36</b>	<b>100</b>	<b>47,619.81</b>	<b>100</b>	<b>16,667.05</b>	<b>100</b>

报告期各期末，公司长期借款分别为 16,667.05 万元、47,619.81 万元、47,726.36 万元和 84,994.32 万元，主要为保证及抵押借款。2021 年及以后，公司增加的长期借款主要用于无锡、南京测试基地的建设。

## 9、租赁负债

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
尚未支付的租赁付款额	2,494.04	3,336.82	3,838.52	9,715.79
减：未确认融资费用	184.55	244.92	322.14	666.95
合计	<b>2,309.49</b>	<b>3,091.90</b>	<b>3,516.38</b>	<b>9,048.84</b>

报告期各期末，公司租赁负债分别为 9,048.84 万元、3,516.38 万元、3,091.90 万元和 2,309.49 万元，主要为测试设备的融资租赁和厂房租赁。随着

融资租赁逐步到期，租赁负债金额持续减少。

## 10、长期应付款

报告期内，公司长期应付款的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
融资租赁款	-	700.00	3,500.00	-

报告期各期末，公司长期应付款期末余额分别为 0 万元、3,500 万元、700 万元和 0 万元，系售后租回形成的长期应付款，占非流动负债的比例分别为 0.00%、5.89%、1.12%和 0.00%。

## 11、递延收益

报告期内，公司递延收益明细如下所示：

单位：万元

项目	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
政府补助	11,561.31	11,124.72	4,675.92	1,797.70

报告期内，公司递延收益为收到与资产相关的政府补助，各期末金额分别为 1,797.70 万元、4,675.92 万元、11,124.72 万元和 11,561.31 万元，占非流动负债的比例分别为 6.53%、7.87%、17.76%和 11.69%。

### （三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2024.6.30/ 2024 年 1-6 月	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度
流动比率（倍）	1.44	1.63	4.01	0.99
速动比率（倍）	1.43	1.63	3.99	0.98
资产负债率（合并）	38.40%	31.86%	29.71%	42.72%
息税折旧摊销前利润 （万元）	17,170.88	36,390.86	43,590.01	26,097.59
利息保障倍数（倍）	1.15	3.89	8.34	9.11

#### 1、短期偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.99 倍、4.01 倍、1.63 倍和 1.44 倍，速动比率分别为 0.98 倍、3.99 倍、1.63 倍和 1.43 倍。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率和可比公司对比如下：

公司名称	流动比率（倍）			
	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
利扬芯片	0.74	0.87	1.51	2.42
华岭股份	1.68	2.25	6.47	5.19
京元电子	2.14	2.84	2.18	1.69
矽格	2.25	2.10	2.77	1.93
欣铨	1.23	1.74	1.85	1.64
平均值	<b>1.61</b>	<b>1.96</b>	<b>2.96</b>	<b>2.57</b>
本公司	<b>1.44</b>	<b>1.63</b>	<b>4.01</b>	<b>0.99</b>
公司名称	速动比率（倍）			
	2024.6.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
利扬芯片	0.67	0.82	1.42	2.26
华岭股份	1.62	2.20	6.44	5.17
京元电子	2.09	2.71	2.05	1.57
矽格	2.20	2.05	2.71	1.89
欣铨	1.23	1.74	1.85	1.64
平均值	<b>1.56</b>	<b>1.90</b>	<b>2.89</b>	<b>2.51</b>
本公司	<b>1.43</b>	<b>1.63</b>	<b>3.99</b>	<b>0.98</b>

注：可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

报告期内，除公司 2022 年通过 IPO 募集大量资金导致指标较高之外，公司流动比率和速动比率均低于可比公司平均水平，主要是由于公司业务发展快，报告期内使用较多银行借款和融资租赁的方式来满足资金需求，且期末应付设备采购款金额较大，进而导致短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债等流动负债金额较大，流动比率和速动比率较低。

## 2、长期偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 42.72%、29.71%、31.86%和 38.40%，2021 年至 2024 年 6 月末，随着公司私募股权融资和 IPO 的成功实施、以及经营业绩的快速增长，公司资产负债率保持合理水平，长期偿债能力稳定。2021 年末，资产负债率较高，但仍处于合理水平，主要因为公司为了扩大产能增加了融资租赁规模和长期借款，以及公司执行新租赁准则导致负债上升所致。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 26,097.59 万元、43,590.01 万元、36,390.86 万元和 17,170.88 万元，利息保障倍数分别为 9.11 倍、8.34 倍、3.89 倍和 1.15 倍。

综上所述，公司资产负债率处于合理水平，息税折旧摊销前利润规模较大，长期偿债能力较强。

公司最近三年一期未发生无法偿还到期债务的情况。截至报告期末，公司不存在对生产经营活动有重大影响的或有负债。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、公司资产周转能力指标

报告期各期，公司资产周转能力相关财务指标如下表所示：

财务指标	2024.6.30/ 2024 年 1-6 月	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度
总资产周转率（次）	0.23	0.21	0.30	0.41
应收账款周转率（次）	2.69	2.59	3.85	4.81
存货周转率（次）	104.97	91.08	65.47	49.05

- 注：1、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；  
2、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；  
3、存货周转率=营业成本/存货平均余额；  
4、上表 2024 年 1-6 月数据已进行年化处理。

##### 2、资产周转能力与可比公司的对比

报告期各期，公司与可比公司总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率的比较情况如下：

##### （1）总资产周转率

公司名称	总资产周转率（次）			
	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
利扬芯片	0.22	0.27	0.31	0.33
华岭股份	0.20	0.26	0.32	0.54
京元电子	0.33	0.45	0.50	0.51
矽格	0.45	0.41	0.50	0.50
欣铨	0.40	0.44	0.51	0.49
平均值	<b>0.32</b>	<b>0.37</b>	<b>0.43</b>	<b>0.47</b>

公司名称	总资产周转率（次）			
	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
本公司	0.23	0.21	0.30	0.41

注：可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：总资产周转率=营业收入/总资产平均余额，2024年1-6月财务指标已经年化处理。

从上表可见，发行人总资产周转率低于同行业可比公司平均水平。与台资企业相比，报告期内公司总资产周转率均较低，主要是由于报告期内公司为满足产能需求，不断扩大生产设备规模，但是收入增长尚处于爬坡期，导致总资产周转率较低。3家台资可比公司的经营时间较长、收入规模及资产规模相对稳定，因此总资产周转率相对较高。

与内资的可比公司利扬芯片和华岭股份相比，2021年至2024年1-6月，公司总资产周转率处于利扬芯片和华岭股份之间的合理范围内。

## （2）应收账款周转率

公司名称	应收账款周转率（次）			
	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
利扬芯片	2.89	3.17	3.65	4.65
华岭股份	3.53	4.47	4.87	6.41
京元电子	3.71	4.51	4.87	4.87
矽格	4.36	4.08	4.79	4.59
欣铨	4.26	4.61	5.29	5.10
平均值	3.75	4.17	4.69	5.12
本公司	2.69	2.59	3.85	4.81

注：可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2024年1-6月财务指标已经年化处理。

2021年至2024年1-6月，公司的应收账款周转率低于同行业可比公司平均水平，主要系公司在报告期内营业收入保持了高于可比公司的高速增长态势，导致各年度的第四季度的收入占全年比重较高，而第四季度的收入的应收账款在资产负债表日还处于信用期，从而导致用于计算应收账款周转率的应收账款期末余额指标偏高，拉低了应收账款周转率。

公司目前处于业务大规模扩张阶段，将持续开展应收账款管理和催收工作，加强应收账款管理。

### (3) 存货周转率

公司名称	存货周转率（次）			
	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
利扬芯片	12.76	15.29	12.41	14.31
华岭股份	18.56	26.58	77.13	229.14
京元电子	16.59	17.93	17.31	19.90
矽格	29.91	30.60	40.14	47.93
欣铨	未披露	未披露	未披露	未披露
平均值	<b>19.46</b>	<b>22.60</b>	<b>36.75</b>	<b>77.82</b>
本公司	<b>104.97</b>	<b>91.08</b>	<b>65.47</b>	<b>49.05</b>

注：1、可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：存货周转率=营业成本/存货平均余额，2024年1-6月财务指标已经年化处理。

2、欣铨未披露存货相关信息

报告期内，公司存货周转率与可比公司相比处于较高水平。可比公司之间存货周转率存在较大差异。华岭股份 2021 年至 2022 年存货周转率显著高于其他可比公司，主要原因系其期末存货仅为少量原材料，金额极小，自 2023 年起，其存货包括合同履行成本和原材料，导致其存货周转率大幅降低。与利扬芯片相比，公司存货周转率较高，主要是由于根据利扬芯片的收入确认原则，其存货由未交付劳务、其他周转材料和库存商品构成，而本公司的存货只有周转材料，因此存货周转率较高。

### (五) 财务性投资情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产余额为 8,500 万元，其中公司投资江苏泰治科技股份有限公司 5,000 万元，为对产业链上游供应商的投资，公司投资芯知微电子（苏州）有限公司 500 万元，为对产业链下游客户的投资，两者均不属于财务性投资。

公司已投资上海信邀创投并实缴出资额 3,000 万元，属于财务性投资，占期末合并报表归属于母公司净资产 246,706.99 万元的比例为 1.22%，比例较低。除此之外，公司最近一期末不存在其他财务性投资的情形。

公司符合《注册管理办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。

## 七、经营成果分析

报告期各期，公司经营成果概况如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	42,991.52	73,652.48	73,302.33	49,314.43
营业成本	30,715.20	44,955.06	37,696.78	24,430.48
营业利润	213.66	9,577.46	24,479.16	15,239.43
利润总额	224.91	9,572.80	24,476.40	15,238.08
净利润	1,085.66	11,799.63	24,362.65	13,226.12
归属于母公司所有者的净利润	1,085.66	11,799.63	24,362.65	13,226.12

报告期各期，公司的净利润分别为 13,226.12 万元、24,362.65 万元、11,799.63 万元及 1,085.66 万元，发行人投资收益及非经常性损益对公司经营成果无重大影响，不存在累计未弥补亏损情况。

2021 年-2022 年，受益于我国集成电路行业的快速发展以及集成电路测试国产化进程的加速，公司营业收入大幅上升。2022 年上半年集成电路市场景气度延续，但市场亦出现分化，消费类产品受到终端需求影响景气度下滑，而汽车、工业控制类产品需求依然旺盛。面对行业变化，公司一方面积极开发引进新客户、加大对老客户新产品的开发力度，另一方面加大对车规级、工业类、高算力等产品的研发投入力度，积极拓展高端晶圆及芯片成品测试，调整产品结构，积极应对市场变化。2022 年度，公司营业收入及净利润均高速增长，公司实现营业收入 73,302.33 万元，同比增长 48.64%，归属于上市公司股东的净利润 24,362.65 万元，同比增长 84.20%。

2023 年，全球终端市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，面对十分不利的外部环境，公司积极调整经营策略，重点发挥自身在高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的突出优势，加快上述领域的测试产能建设、研发投入和客户订单开拓，有效对冲了其他领域需求的下降，最终实现 2023 年的营业较 2022 年略有增长。虽然公司营业收入较上一年略有增长，但是 2023 年度公司净利润较上一年出现较大幅度的下降，主要原因包括以下几点：一是 2023 年公司实施了股权激励，导致全年增加股份支付费用 3,464.35 万元；二是公司继

续实施 IPO 募投项目及超募资金项目，对无锡、南京两个测试基地产能进行扩张，导致折旧、摊销、人工成本、能源费用等刚性的固定成本较 2022 年度相比增加较大；三是公司一方面积极开发引进新客户、加大对老客户新产品的开发力度，另一方面加大对高算力芯片、车规及工业级高可靠性芯片的研发投入力度，积极拓展高端晶圆及芯片成品测试，导致研发、销售等费用较 2022 年度均上升较大。

2024 年上半年，公司净利润为 1,085.66 万元，较上年同期下降 5,990.68 万元。虽然公司营业收入较上年同期增幅达 37.85%，但净利润较上年同期相比下降 84.66%，主要原因如下：

1、在人才激励机制的持续深化下，继公司在 2023 年推出的限制性股票激励计划后，本年度公司继续实施 2024 年限制性股票激励计划，上述两期限制性股票激励计划在报告期内合计新增股份支付费用 3,382.52 万元，剔除股份支付费用的影响后，2024 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 4,468.18 万元。

2、为进一步提升公司核心竞争力，巩固公司在独立第三方测试行业内的内资龙头地位，报告期内，公司加大高算力芯片、先进架构及先进封装芯片、高可靠性芯片等核心领域的研发投入，研发投入合计 6,449.91 万元，较上年同期增幅达 66.77%；同时因部分研发人员被授予限制性股票，研发费用中股份支付部分的费用为 1,496.15 万元，剔除股份支付费用的影响后，研发投入合计 4,953.76 万元，同比增长 28.08%。

3、公司 2023 年逆周期进行产能扩张的幅度较大和报告期内公司继续实施超募资金项目对无锡、南京两个测试基地产能进行扩张导致截至报告期末累计折旧、摊销、人工费用等成本增长较大，降低了公司的利润率。

自 2023 年以来，由于集成电路行业周期下行，公司净利润整体呈现下降趋势，但是从 2024 年 6 月开始，该趋势已经发生扭转。2024 年 6 月，公司单月营业收入创出历史新高，单月扣非净利润达到良好水平。2024 年 7 月和 8 月，公司单月营业收入和净利润较 2024 年 6 月份继续改善，有望带动 2024 年第三季度的盈利情况恢复到良好水平。

## （一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	38,353.28	89.21	68,692.59	93.27	70,245.20	95.83	47,210.65	95.73
其他业务收入	4,638.25	10.79	4,959.89	6.73	3,057.13	4.17	2,103.78	4.27
<b>合计</b>	<b>42,991.52</b>	<b>100</b>	<b>73,652.48</b>	<b>100</b>	<b>73,302.33</b>	<b>100</b>	<b>49,314.43</b>	<b>100</b>

2021年-2024年上半年，公司营业收入分别为49,314.43万元、73,302.33万元、73,652.48万元及42,991.52万元，分别同比增长48.64%、0.48%及37.85%。

2021年-2022年，公司主营业务收入持续增长，主要原因有两点：一是行业处于景气上行周期，国产化成为行业重要趋势，公司作为内资测试厂商中的龙头企业，获得了难得的发展机遇；二是公司加大研发投入和优质客户的开拓力度，并积极建设测试产能，为公司营业收入快速增长提供了有力保障。

从2022年四季度开始，集成电路行业进入下行周期。面对十分不利的外部环境，公司积极调整经营策略，重点发挥自身在高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的突出优势，加快上述领域的测试产能建设、研发投入和客户订单开拓，有效对冲了其他领域需求的下降，最终实现2023年的营业收入比2022年略有增长。从全年的角度来看，2023年的营业收入整体呈现前低后高，持续改善的态势。

2024年上半年，公司持续聚焦高算力芯片、先进架构及先进封装芯片、高可靠性芯片的测试服务领域，公司所在半导体行业处于上游库存逐步消化及下游需求逐步回暖的阶段，受益于市场复苏对测试需求增加和部分新客户进入量产，公司2024年上半年实现营业收入42,991.52万元，同比增长37.85%，其中，公司第二季度的营业收入为24,636.21万元，单季度营收创出历史新高。

报告期内，公司营业收入的具体情况如下：

### 1、按产品类别分析

公司的主营业务收入包含晶圆测试服务收入和芯片成品测试服务收入。报告期内，各业务类型收入的具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆测试	23,533.16	61.36	44,250.82	64.42	42,198.22	60.07	27,434.51	58.11
芯片成品测试	14,820.12	38.64	24,441.77	35.58	28,046.98	39.93	19,776.14	41.89
主营业务收入	<b>38,353.28</b>	<b>100</b>	<b>68,692.59</b>	<b>100</b>	<b>70,245.20</b>	<b>100</b>	<b>47,210.65</b>	<b>100</b>

报告期各期，公司晶圆测试收入金额分别为 27,434.51 万元、42,198.22 万元、44,250.82 万元和 23,533.16 万元，占主营业务收入的比重分别为 58.11%、60.07%、64.42%和 61.36%；公司芯片成品测试收入金额分别为 19,776.14 万元、28,046.98 万元、24,441.77 万元和 14,820.12 万元，占主营业务收入的比重分别为 41.89%、39.93%、35.58%和 38.64%。

## 2、按区域结构分析

报告期内，公司主营业务收入的客户所在区域分布情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	23,062.68	60.13	44,880.46	65.34	44,850.71	63.85	28,002.55	59.31
华南	10,541.84	27.49	13,451.11	19.58	12,672.80	18.04	12,648.90	26.79
华北	2,103.41	5.48	4,800.74	6.99	3,570.42	5.08	3,263.03	6.91
西南	999.08	2.60	2,083.05	3.03	1,612.94	2.30	453.75	0.96
境外	1,646.26	4.29	3,477.23	5.06	7,538.34	10.73	2,842.42	6.02
合计	<b>38,353.28</b>	<b>100</b>	<b>68,692.59</b>	<b>100</b>	<b>70,245.20</b>	<b>100</b>	<b>47,210.65</b>	<b>100</b>

报告期内，公司主营业务收入主要来自华东和华南地区，来自华东和华南地区客户的收入占当期主营业务收入的比重分别为 86.10%、81.89%、84.92%和 87.62%。以上海为代表的长三角地区、以北京为代表的环渤海区域和以深圳为代表的珠三角区域是中国集成电路产业的三大主要区域，公司营业收入的区域分布与产业集群的分布相匹配。

## 3、按季度构成分析

报告期内，公司主营业务收入按照季度构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	17,338.66	45.21	13,494.54	19.64	15,870.06	22.59	9,723.09	20.60
第二季度	21,014.62	54.79	15,995.92	23.29	18,226.07	25.95	10,931.65	23.16
第三季度	-	-	18,862.71	27.46	17,877.88	25.45	12,190.19	25.82
第四季度	-	-	20,339.42	29.61	18,271.20	26.01	14,365.72	30.43
合计	<b>38,353.28</b>	<b>100</b>	<b>68,692.59</b>	<b>100</b>	<b>70,245.20</b>	<b>100</b>	<b>47,210.65</b>	<b>100</b>

2021年-2022年，行业处于上行周期，同时公司处于高速成长期，因此各个季度主营业务收入基本保持快速增长的趋势。

2023年，集成电路行业进入下行周期，受此影响，公司2023年第一季度主营业务收入处于低谷，为了应对十分不利的外部环境，公司积极调整经营策略，重点发挥自身在高端芯片、车规级芯片、工业级芯片等领域的突出优势，从第二季度起主营业务收入有所恢复，第三季度主营业务收入大幅增长，创出单季度主营业务收入历史新高，第四季度继续保持增长态势，单季度主营业务收入再次创出历史新高，超过了2亿元。

随着半导体行业逐步复苏和公司产能利用率不断提高等原因，公司2024年半年度实现营业收入42,991.52万元，较上年同期增长37.85%，其中2024年第二季度的单季度主营业务收入创出历史新高。

#### 4、其他业务收入构成

报告期内，公司其他业务收入构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硬件销售	3,362.42	72.49	2,745.30	55.35	1,389.35	45.45	1,605.30	76.31
设备租金及其他	1,275.82	27.51	2,214.59	44.65	1,667.77	54.55	498.48	23.69
合计	<b>4,638.25</b>	<b>100</b>	<b>4,959.89</b>	<b>100.00</b>	<b>3,057.13</b>	<b>100</b>	<b>2,103.78</b>	<b>100</b>

公司其他业务收入主要为硬件销售（探针卡、KIT、Socket等）以及设备租赁等收入。报告期内，公司其他业务收入分别为2,103.78万元、3,057.13万元、4,959.89万元和4,638.25万元，占营业收入比重分别为4.27%、4.17%、

6.73%和 10.79%，其他业务收入占比较小。

## （二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	27,467.50	89.43	42,366.60	94.24	36,053.22	95.64	23,055.16	94.37
其他业务成本	3,247.69	10.57	2,588.46	5.76	1,643.56	4.36	1,375.33	5.63
<b>合计</b>	<b>30,715.20</b>	<b>100</b>	<b>44,955.06</b>	<b>100</b>	<b>37,696.78</b>	<b>100</b>	<b>24,430.48</b>	<b>100</b>

报告期各期，公司主营业务成本占营业成本的比重分别为 94.37%、95.64%、94.24%及 89.43%，与主营业务收入占比相匹配。其他业务成本主要是公司硬件销售和租赁的成本。

### 1、按产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本中各类测试服务具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆测试	15,668.01	57.04	25,291.65	59.70	18,349.95	50.9	10,997.75	47.70
芯片成品测试	11,799.49	42.96	17,074.95	40.30	17,703.27	49.1	12,057.41	52.30
<b>主营业务成本</b>	<b>27,467.50</b>	<b>100</b>	<b>42,366.60</b>	<b>100</b>	<b>36,053.22</b>	<b>100</b>	<b>23,055.16</b>	<b>100</b>

报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入结构基本一致，由晶圆测试成本和芯片成品测试成本构成。

### 2、按要素构成分析

报告期内，公司主营业务成本具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
设备折旧及租赁费用	13,016.21	47.39	19,488.79	46.00	14,224.12	39.45	10,281.08	44.59
人工成本	8,170.22	29.75	13,476.59	31.81	12,871.25	35.70	7,946.26	34.47
制造费用	3,739.86	13.62	5,224.41	12.33	5,706.07	15.83	3,304.94	14.33

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
能源费用	2,541.21	9.25	4,176.82	9.86	3,251.78	9.02	1,522.88	6.61
主营业务成本	<b>27,467.50</b>	<b>100</b>	<b>42,366.60</b>	<b>100</b>	<b>36,053.22</b>	<b>100</b>	<b>23,055.16</b>	<b>100</b>

报告期内，生产设备的折旧及租赁费用占当期主营业务成本的比重分别为44.59%、39.45%、46.00%和47.39%，2023年和2024年上半年的占比上升明显，主要因为公司IPO募投项目及无锡、南京测试基地相继投产，正处于产能利用率爬坡期，因此设备折旧在成本中的占比上升。

报告期内，人工成本占当期主营业务成本的比重分别为34.47%、35.70%、31.81%和29.75%，整体呈下降趋势，主要原因有两点：一是公司加大自动化、智能化生产水平，减少单位生产用工数量；二是公司推行“高端化战略”，高端测试业务附加值较高，人员工资占比较低。

报告期内，制造费用占当期主营业务成本的比重分别为14.33%、15.83%、12.33%和13.62%。2021年-2022年，制造费用占比基本保持稳定，2023年制造费用占成本的比重有所下降，主要是因为机物料成本下降所致。机物料成本下降的原因有两点：一是由于公司继续推行“高端化战略”，导致高端测试平台的收入比重从2022年的68.58%上升至2023年的75.96%，而高端测试平台的探针卡等机物料成本基本由客户承担；二是2023年行业进入下行周期，公司加强了成本控制，通过循环利用等方式，减少晶圆盒、托盘等高价值量耗材的消耗量。2024年1-6月，制造费用占成本的比重上升，主要是由于公司芯片成品测试业务量上升，导致对包装耗材的需求增加，由此导致机物料成本增加所致。

报告期内，能源费用占主营业务成本的比重分别为6.61%、9.02%、9.86%和9.25%，2022年和2023年度占比上升明显，主要因为公司IPO募投项目及无锡、南京测试基地相继投产，正处于产能利用率爬坡期，洁净厂房的利用率低于前两年，维持洁净厂房24小时正常运转的各类能源费用占比上升。

### （三）毛利及毛利率变动分析

#### 1、毛利分析

##### （1）综合毛利分析

报告期内，公司毛利的具体情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	10,885.78	88.67	26,325.99	91.74	34,191.98	96.03	24,155.49	97.07
其他业务毛利	1,390.56	11.33	2,371.43	8.26	1,413.57	3.97	728.45	2.93
合计	<b>12,276.34</b>	<b>100</b>	<b>28,697.42</b>	<b>100</b>	<b>35,605.55</b>	<b>100</b>	<b>24,883.94</b>	<b>100</b>

报告期内，公司毛利总额分别为 24,883.94 万元、35,605.55 万元、28,697.42 万元及 12,276.34 万元，公司毛利总额变化趋势与营业收入的变化趋势基本保持一致。公司主营业务毛利占毛利总金额的比例分别为 97.07%、96.03%、91.74%及 88.67%，是公司毛利的主要来源。

## (2) 主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利的具体情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆测试	7,865.15	72.25	18,959.17	72.02	23,848.27	69.75	16,436.76	68.05
芯片成品测试	3,020.63	27.75	7,366.82	27.98	10,343.71	30.25	7,718.73	31.95
主营业务毛利	<b>10,885.78</b>	<b>100</b>	<b>26,325.99</b>	<b>100</b>	<b>34,191.98</b>	<b>100</b>	<b>24,155.49</b>	<b>100</b>

公司主营业务毛利主要来源于晶圆测试和芯片成品测试服务，其中晶圆测试毛利占毛利总额的比重分别为 68.05%、69.75%、72.02%和 72.25%，晶圆测试服务对公司毛利贡献较大。

## 2、毛利率分析

### (1) 综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

财务指标	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
主营业务毛利率	28.38%	38.32%	48.68%	51.17%
其他业务毛利率	29.98%	47.81%	46.24%	34.63%
综合毛利率	<b>28.56%</b>	<b>38.96%</b>	<b>48.57%</b>	<b>50.46%</b>

报告期内，公司的综合毛利率分别为 50.46%、48.57%、38.96%和 28.56%，

其中 2023 年和 2024 年上半年综合毛利率下降较为明显，主要因为集成电路行业周期处于下行影响，受主营业务毛利率下降的拖累所致。

## (2) 主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务的毛利率情况如下：

财务指标	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
晶圆测试	33.42%	42.84%	56.51%	59.91%
芯片成品测试	20.38%	30.14%	36.88%	39.03%
<b>主营业务毛利率</b>	<b>28.38%</b>	<b>38.32%</b>	<b>48.68%</b>	<b>51.17%</b>

报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 51.17%、48.68%、38.32%和 28.38%。2021 年和 2022 年主营业务毛利率处于较高水平，主要因为集成电路行业处于景气周期，晶圆测试和芯片成品测试两项业务均处于良好的盈利水平。

2023 年主营业务毛利率为 38.32%，较 2022 年下降 10.36 个百分点，下降幅度较大，主要原因有三点：①由于 2023 年集成电路行业进入了下行周期，部分客户和产品的测试服务价格下降 5%-15%的幅度；②2023 年，深圳子公司成立并投产，同时公司继续扩充无锡及南京子公司测试基地的产能，加之下半年 IPO 募投项目达产，使得相应的折旧和摊销、需要支付的人工费用和能源费用等刚性的固定成本及费用较上年相比增加较大，而主营业务收入受行业周期下行的影响，在 2023 年的上半年下降幅度较大，虽然下半年业务复苏态势明显并创出单季度历史新高，但 2023 年全年的主营业务收入整体仍同比下降了 2.21%。③2023 年下半年，公司实施股权激励，计入主营业务成本的股份支付费用较上一年新增约 672.06 万元。

2024 年上半年主营业务收入同比增长 30.05%，继续保持复苏态势，但是主营业务毛利率为 28.38%，较 2023 年下降了 9.94 个百分点。2024 年上半年，主营业务收入和毛利率的变动出现相反趋势，主要原因如下：①测试价格下降。2023 年集成电路行业进入了下行周期之后，部分客户和产品的测试服务价格下降 5%-15%的幅度，上述经历了降价的客户和产品的收入占比在 2024 年 1-6 月上升，导致整体的利润率水平下降。②固定成本上升。如前文所述，公司 2023 年和 2024 年上半年持续实施逆周期扩产，使得相应的折旧和摊销、需要支付的人工费用和能源费用等刚性的固定成本及费用较上年相比增加较大。③收入结

构的变动。2023年，中端测试业务的收入受行业去库存的影响大幅下降，在主营业务收入中的比例只有24.04%，2024年1-6月随着行业的复苏，中端测试业务恢复到正常水平，在主营业务收入中的比例上升到33.31%。由于中端测试业务的毛利率不到高端测试业务的一半，因此其收入占比上升拉低了整体毛利率。

④股份支付费用的影响。2023年，主营业务成本中的股份支付费用为672.06万元，占主营业务收入的比例为0.98%，而2024年1-6月主营业务成本中的股份支付费用为680.26万元，占主营业务收入的比例为1.77%。

### 3、公司毛利率与同行业可比公司比较分析

根据各家上市公司公开披露的信息，报告期各期，公司毛利率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司简称	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
利扬芯片	24.50%	30.33%	37.24%	52.78%
华岭股份	29.52%	51.12%	49.71%	53.92%
<b>2家内资可比公司平均值</b>	<b>27.01%</b>	<b>40.73%</b>	<b>43.48%</b>	<b>53.35%</b>
京元电子	34.18%	33.74%	35.54%	30.66%
矽格	25.92%	23.12%	29.57%	29.66%
欣铨	27.59%	34.68%	40.83%	37.15%
<b>3家台资可比公司平均值</b>	<b>29.23%</b>	<b>30.51%</b>	<b>35.31%</b>	<b>32.49%</b>
<b>本公司</b>	<b>28.56%</b>	<b>38.96%</b>	<b>48.57%</b>	<b>50.46%</b>

注：1、可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算,公式为（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入\*100%。

报告期内，公司的毛利率水平和变动趋势与2家内资可比公司接近。

2021年-2023年，公司的毛利率均高于3家台资巨头，主要原因有以下几点：①中国台湾地区半导体产业发展高度成熟，集成电路产业规模处于世界前列，各巨头激烈的产业竞争导致产能利用率和测试价格相对较低；②集成电路测试属于人才密集型行业，需要大量半导体、微电子和IT人才，人工成本是该行业主要营业成本之一，与中国大陆的“工程师红利”相比，中国台湾地区的工程师和一线工人的人工成本较高，所以导致其毛利率较低。

2024年上半年，公司的毛利率低于3家台资巨头，一方面因为公司逆周期进行产能扩张的幅度较大，固定成本上升较多所致，另一方面因为3家台资巨

头的业务更加多元化，业务更加稳健，并且受人工智能等高端测试业务的拉动更加明显。

#### （四）期间费用分析

报告期各期，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2024年1-6月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重
销售费用	1,522.65	3.54	2,401.62	3.26	1,692.62	2.31	1,115.38	2.26
管理费用	3,220.03	7.49	5,246.41	7.12	3,438.75	4.69	2,179.41	4.42
研发费用	6,449.91	15.00	10,380.63	14.09	6,919.39	9.44	4,774.28	9.68
财务费用	1,487.20	3.46	3,728.75	5.06	3,393.89	4.63	1,516.22	3.07
合计	<b>12,679.79</b>	<b>29.49</b>	<b>21,757.42</b>	<b>29.54</b>	<b>15,444.65</b>	<b>21.07</b>	<b>9,585.30</b>	<b>19.44</b>

报告期内，公司期间费用总额分别为 9,585.30 万元、15,444.65 万元、21,757.42 万元和 12,679.79 万元，占当期营业收入比重分别为 19.44%、21.07%、29.54%和 29.49%。期间费用由销售费用、管理费用、研发费用和财务费用构成，报告期内，随着公司业务的快速发展和生产经营规模的不断扩大，期间费用率呈现逐年上升的趋势。

##### 1、销售费用分析

报告期各期，公司销售费用构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
职工薪酬	727.01	1,341.84	1,059.20	644.96
销售运费	419.01	541.21	465.71	259.50
股份支付	249.57	214.55	-	-
业务开拓费	0.11	32.07	83.84	110.17
业务招待费	101.64	207.20	43.19	76.91
差旅交通费	23.61	61.10	14.45	13.88
其他	1.70	3.66	26.24	9.96
合计	<b>1,522.65</b>	<b>2,401.62</b>	<b>1,692.62</b>	<b>1,115.38</b>

报告期各期，公司销售费用为 1,115.38 万元、1,692.62 万元、2,401.62 万元和 1,522.65 万元，主要为销售人员职工薪酬和销售运费。报告期内，随着公司

业务规模不断扩大，销售人员平均人数逐年上升，销售人员总薪酬逐年上升，公司销售费用也呈现逐年上涨的趋势。

## 2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
职工薪酬	1,322.25	2,615.78	1,764.54	931.64
股份支付	956.53	1,063.99	-	-
折旧摊销	277.37	546.09	490.07	330.43
中介服务费	162.74	201.04	163.36	256.66
维修费	4.05	9.78	276.49	145.16
办公费	115.75	152.68	202.62	130.28
房租水电费	192.45	258.57	243.99	126.91
业务招待费	85.80	142.24	144.39	123.31
差旅交通费	52.61	116.91	81.18	53.65
其他	50.48	139.34	72.11	81.37
<b>合计</b>	<b>3,220.03</b>	<b>5,246.41</b>	<b>3,438.75</b>	<b>2,179.41</b>

报告期各期，公司管理费用分别为 2,179.41 万元、3,438.75 万元、5,246.41 万元及 3,220.03 万元，主要包括职工薪酬、股份支付费用、折旧摊销、中介服务费和房租水电费，上述费用占当期管理费用的比重分别为 75.51%、77.41%、89.31%和 90.41%。随着公司业务规模扩大，管理员工资、奖金上涨及员工数量增加，导致报告期内管理人员总薪酬呈现逐年上升的趋势。

## 3、研发费用分析

报告期内，公司各期研发费用构成如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
职工薪酬	3,432.50	6,388.95	5,278.46	3,619.80
股份支付	1,496.15	1,513.75	-	-
机物料消耗费	211.64	447.33	381.72	256.21
技术服务费	-	76.96	105.60	125.39
能源费	268.40	344.75	240.55	125.33

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
专利使用权	15.91	31.82	52.18	31.82
折旧与摊销	1,023.01	1,574.37	852.74	596.70
其他	2.30	2.71	8.14	19.03
<b>合计</b>	<b>6,449.91</b>	<b>10,380.63</b>	<b>6,919.39</b>	<b>4,774.28</b>

报告期各期，公司研发费用分别为 4,774.28 万元、6,919.39 万元、10,380.63 万元及 6,449.91 万元，研发费用主要由职工薪酬、股份支付费用、折旧与摊销和机物料消耗费等构成。

报告期内，公司研发费用率分别为 9.68%、9.44%、14.09%及 15.00%，总体呈现持续上升趋势，尤其是 2023 年度及 2024 年 1-6 月增长较快，主要原因包括以下两方面：一方面是由于公司正在实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划，部分研发人员被授予了限制性股票，对应的股份支付费用计入相应期间内研发费用，导致研发费用有所增长；另一方面是由于公司依据行业发展趋势及重点客户需求，在高算力芯片、车规及工业级高可靠性芯片等方向的芯片测试技术方面进行了持续投入。上述因素综合导致报告期内公司研发费用率有所上升。

#### 4、财务费用分析

报告期内，公司各期财务费用构成如下表所述：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
利息支出	1,537.56	3,306.93	3,335.44	1,817.50
汇兑损益	48.75	863.19	425.13	-176.17
票据贴现支出	-	-	-	61.16
手续费	11.17	16.02	105.94	17.49
减：利息收入	110.29	457.39	472.61	203.76
<b>合计</b>	<b>1,487.20</b>	<b>3,728.75</b>	<b>3,393.89</b>	<b>1,516.22</b>

公司各期财务费用金额分别为 1,516.22 万元、3,393.89 万元、3,728.75 万元及 1,487.20 万元，主要是融资租赁和银行借款利息支出。报告期内，公司大力扩张产能，银行借款和融资租赁是公司债务融资的重要手段。公司资信情况良好，与多家商业银行保持着良好的长期合作关系，随着生产设备采购规模的不

断扩大，公司充分利用财务杠杆，增加债务融资，财务费用相应上升。

## （五）利润表其他科目分析

### 1、其他收益

报告期内，公司其他收益主要为收到的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
与资产相关的政府补助	723.41	929.71	394.08	68.63
与收益相关的政府补助	25.41	705.40	3,226.21	426.25
代扣个人所得税手续费返还	12.94	2.23	3.58	1.08
增值税加计抵减	-	25.18	1,156.03	-
<b>合计</b>	<b>761.75</b>	<b>1,662.52</b>	<b>4,779.89</b>	<b>495.97</b>

### 2、信用减值损失

信用减值损失包括应收账款、应收票据和其他应收款坏账损失。报告期各期，公司信用减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
坏账损失	-250.02	-467.33	-529.28	-521.45

报告期内，公司信用减值损失分别为-521.45万元、-529.28万元、-467.33万元和-250.02万元，主要由公司各期应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失构成。

## 八、现金流量状况分析

### （一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
销售商品、提供劳务收到的现金	45,106.52	68,874.27	67,292.67	45,056.50
收到的税费返还	-	4,283.57	9,138.26	820.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,360.19	8,560.48	4,847.46	2,051.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>46,466.71</b>	<b>81,718.32</b>	<b>81,278.39</b>	<b>47,928.39</b>

项目	2024年 1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
购买商品、接受劳务支付的现金	8,696.11	8,501.97	7,110.28	7,350.34
支付给职工以及为职工支付的现金	14,826.96	23,597.31	20,493.19	11,713.96
支付的各项税费	649.77	502.12	1,301.71	1,038.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,053.16	2,861.99	2,399.63	2,593.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>26,226.01</b>	<b>35,463.38</b>	<b>31,304.81</b>	<b>22,696.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,240.70</b>	<b>46,254.94</b>	<b>49,973.58</b>	<b>25,232.12</b>

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 25,232.12 万元、49,973.58 万元、46,254.94 万元和 20,240.70 万元。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 98.06%，主要是公司业务发展态势良好，业务规模不断扩大，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同比减少 7.44%，主要系 2023 年成本费用上升及收到的政府补助减少所致。

## （二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年 1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
收回投资收到的现金	63,829.96	451,807.08	32,500.00	3,869.00
取得投资收益收到的现金	194.08	1,401.53	90.39	23.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81.70	214.54	1,013.10	223.64
收到其他与投资活动有关的现金	-	518.57	3,272.30	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>64,105.74</b>	<b>453,941.72</b>	<b>36,875.79</b>	<b>4,116.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,988.63	122,156.14	80,242.49	67,394.67
投资支付的现金	58,815.09	400,307.08	103,500.00	870.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>122,803.72</b>	<b>522,463.21</b>	<b>183,742.49</b>	<b>68,264.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-58,697.98</b>	<b>-68,521.50</b>	<b>-146,866.69</b>	<b>-64,148.59</b>

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-64,148.59 万元、-146,866.69 万元、-68,521.50 万元和-58,697.98 万元，主要是购建固定资产等长期资产支出和购买理财产品的支出。

### （三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年 1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
吸收投资收到的现金	-	-	134,095.74	20,000.00
取得借款收到的现金	55,582.40	26,767.00	62,882.13	32,141.22
收到其他与筹资活动有关的现金	70.58	-	7,000.00	10,690.61
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>55,652.99</b>	<b>26,767.00</b>	<b>203,977.87</b>	<b>62,831.82</b>
偿还债务支付的现金	17,265.88	26,110.98	27,840.61	5,773.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,004.57	10,426.80	2,155.87	879.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,183.28	7,491.31	26,666.20	12,223.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>24,453.72</b>	<b>44,029.09</b>	<b>56,662.69</b>	<b>18,875.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,199.26</b>	<b>-17,262.09</b>	<b>147,315.18</b>	<b>43,956.15</b>

报告期内，公司为适应行业的快速发展，通过股东增加投入、银行借款、融资租赁等方式补充营运资金、扩大生产经营规模。公司筹资活动现金流入主要为首次公开发行股票募集资金和取得银行借款收到的现金；筹资活动现金流出主要为支付融资租赁的款项和偿还债务支付的现金。

2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系当期收到公司首次公开发行股票募集资金所致。

## 九、资本性支出分析

### （一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出主要是IPO募投项目集成电路测试产能建设项目、研发中心项目以及本次募集资金拟投向的无锡和南京测试基地项目。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为67,394.67万元、80,242.49万元、122,156.14万元及63,988.63万元，主要是用于支付上述项目的工程建设及设备购置款项。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的资本性支出主要为实施本次募集资金投资项目支出，项

项目建设完成后将进一步提升公司测试设备的产能和研发实力。公司本次募集资金投资项目参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。

截至本募集说明书出具日，除上述情况外，公司暂无可预见的重大资本性支出计划。

### （三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

公司扩充产能的相关资本性支出的主要建设目的为提高公司晶圆测试、芯片成品测试等主要服务的能力，相关投入属于科技创新领域。

公司在研发中心等建设项目上的资本性支出旨在进一步培养集成电路测试领域的优秀研发人才，购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发，相关投入属于科技创新领域。

报告期内，公司的资本性支出围绕主营业务进行，通过持续的资本性支出，公司的产能得以增加、研发和技术水平持续提升，为公司经营业绩的增长奠定坚实基础。本次募集资金投资项目系公司现有业务的延伸和扩展，服务于科技创新领域，符合国家战略方向和行业发展趋势。

## 十、技术创新分析

公司主要从事集成电路测试及解决方案服务，通过多年的技术积累和市场开拓，已在晶圆测试、芯片成品测试及集成电路测试方案开发等方面积累了丰富的核心技术和经验，拥有较强的自主开发测试方案的能力和高效可靠的集成电路测试服务能力，并赢得了众多的长期客户。

### （一）公司的技术先进性及具体表现

公司成立以来专注于测试工艺的改进和不同类型芯片测试方案的开发，公司主要核心技术来源于自主研发，相关技术在生产应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中。公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。

在测试方案开发方面，公司建立起了从软件开发到硬件设计的完整研发体系，拥有基于爱德万 V93000、泰瑞达 J750、泰瑞达 UltraFlex 和 Chroma 等中

高端平台的复杂 SoC 测试解决方案开发能力，可开发的芯片类型包括 CPU、GPU、AI、IOT、云计算芯片、高速数字通信芯片、高速数字接口芯片、射频收发芯片、射频前端芯片、数模转换芯片、图像传感器芯片、汽车动力和安全控制芯片、车规毫米波雷达芯片、闪存存储芯片、区块链芯片、MEMS、图像识别、FPGA、DSP、MCU、数据加密、高精度电源管理芯片等，在行业内持续保持方案开发的领先优势。

在测试技术水平方面，公司测试技术水平主要体现在晶圆测试的尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距以及芯片成品测试的封装尺寸大小、测试频率等技术指标，公司在上述测试技术指标保持国内领先地位，达到或者接近国际一流厂商水平。

在生产自动化方面，公司自主开发的测试生产管理系统在晶圆测试预警与反馈、测试良率分析、远程测试控制、生产回溯与质量优化、无纸化作业等方面实现了全流程自动化，同时能够满足测试数据安全、管理及共享等需求，不仅提高了测试效率、降低了测试成本，而且大幅度减少了测试中的呆错现象，保证了测试服务的品质。

截至报告期末，公司及其子公司已取得 99 项专利，其中发明专利 16 项，实用新型专利 83 项。公司拥有的核心技术如测试方案开发技术、测试工艺难点突破与精益测试提效技术、设升级技术、测试治具设计技术、自动化测试及数据分析技术均已应用在公司日常的量产测试中。凭借着稳定的测试量品质和较高的测试量产效率，公司获得了以客户 A、紫光展锐、比特大陆、晶晨股份、中兴微电子等行业高端客户的认可。

## （二）正在从事的研发项目及进展情况

截至报告期末，公司主要在研项目 15 项，具体情况如下：

序号	项目名称	研发形式	项目进度
1	成品芯片测试智能化管理	自主研发	进行中
2	车规测距芯片的测试技术的降本增效开发	自主研发	进行中
3	基于 93K 及 J750 平台的测试方案开发（四期）	自主研发	进行中
4	新兴 5.5G 射频前端芯片晶圆测试方案开发	自主研发	进行中
5	人工智能芯片可靠性验证平台（三期）	自主研发	进行中

序号	项目名称	研发形式	项目进度
6	车规级 SoC 芯片晶圆及成品测试方案开发	自主研发	进行中
7	高性能 Chiplet 芯片成品测试方案开发	自主研发	进行中
8	低中高全功率全封装模式老化板兼容性架构平台	自主研发	进行中
9	恒温恒湿防尘防静电智能管理老化板仓储管理（二期）	自主研发	进行中
10	高功率大尺寸视觉全自动翻盖机械手老化板上下料设备	自主研发	进行中
11	成品芯片烘烤系统防呆研发	自主研发	进行中
12	分布式高可用高负载自动化分片数据存储引擎	自主研发	进行中
13	车规级高精测试参数测试方法	自主研发	进行中
14	FT 小封装体 MTBJ 综合效率提升	自主研发	进行中
15	跨平台晶圆测试数据传输分析系统	自主研发	进行中

### （三）保持持续技术创新的机制和安排

公司保持持续技术创新的机制和安排参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施”。

## 十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

### （一）重大担保事项

截至报告期末，公司不存在为合并报表范围以外的主体提供担保的事项。

### （二）重大仲裁、诉讼及其他或有事项

截至报告期末，公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司不存在其他或有事项。

### （三）重大期后事项

截至本募集说明书出具日，公司不存在需要披露的重大期后事项。

### （四）其他重要事项

截至报告期末，公司无其他需披露的重要事项。

## 十二、本次发行对公司的影响

### （一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目是建立在公司现

有业务基础上的产能扩充，有利于公司在集成电路测试领域的进一步拓展并巩固公司的市场地位，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

### **（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化**

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充，有利于公司紧跟国家政策并进一步扩大公司在集成电路测试领域的产能布局，有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力和科技创新能力。

### **（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化**

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

## 第五节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金投资项目的的基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 117,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	20,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	27,500.00	27,500.00
合计		<b>216,240.00</b>	<b>117,500.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目的经营前景

本次 2 个募投项目的产能扩张聚焦于“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”两个方向，“高端芯片测试”优先服务于高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）的测试需求，“高可靠性芯片测试”优先服务于车规级芯片、工业级芯片的测试需求。

在高端芯片方面，2018 年以后，SoC 主控芯片、CPU、GPU、AI、FPGA 等各类高端芯片的发展获得国内芯片设计公司的空前重视。以华为海思、紫光展锐为代表的旗舰级消费终端 SoC 主控芯片，以华为海思、海光信息、龙芯中科、兆芯、飞腾为代表的 CPU，以景嘉微、壁仞科技、摩尔线程、燧原科技、沐曦为代表的 GPU，以华为海思、寒武纪、紫光展锐、地平线、芯驰、黑芝麻、平头哥、比特大陆等为代表的 AI 芯片或自动驾驶 AI 芯片，以及以紫光国微、

复旦微电、安路科技、高云半导体为代表的 FPGA 芯片，不断经过研发迭代、持续升级，部分产品已经进入量产阶段，大部分产品在未来几年内陆续进入大规模量产爆发期。

在车规级芯片方面，全球车规级芯片长期被英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨、罗姆等欧美日 IDM 厂商垄断，我国的国产化率不到个位数。随着我国新能源汽车的飞速发展和自动驾驶时代的临近，车规级芯片国产化的需求越来越迫切，2020 年以来，以地平线、芯驰科技、黑芝麻、杰发科技、合肥智芯等为代表的一大批厂商开始加大车规级芯片的开发和投入，相关产品在未来几年内陆续进入大规模量产爆发期。

因此，大量国产高端芯片和车规级芯片即将进入量产爆发期，配套的“高端测试”和“高可靠性测试”未来需求旺盛，本次募集资金投资项目的经营前景广阔。

### 三、与现有业务或发展战略的关系

#### （一）本次募投项目与现有业务或发展战略的关系，既有业务的发展概况

公司的发展战略是“致力于成为国内领先、世界一流的集成电路测试服务及解决方案提供商”。本次募投项目主要用于公司现有主营业务集成电路测试业务的产能扩充，重点扩充“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能，提高公司集成电路测试服务的效率和交付能力，有利于优化公司收入结构，增强公司在芯片测试领域的市场竞争力，提高公司市场份额。公司本次拟使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金，有助于缓解公司未来的资金压力，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。本次募投项目的实施紧紧围绕公司主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略。项目的实施是公司把握市场机遇、快速提升集成电路测试服务的品质和综合竞争力的重要举措，不仅有助于提升公司测试规模和市场竞争力，满足终端客户需求，而且能够提高规模化成本竞争优势，获取更大的增值空间，符合公司发展战略需要。

公司是国内领先的独立第三方集成电路测试企业，先后被评为国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、浦东新区企业研发机构。自 2016 年

5 月成立以来，公司经营业绩实现了高速增长，成为第三方集成电路测试行业成长性较为突出的企业之一。截至目前，公司已经发展成为第三方集成电路测试行业中规模最大的内资企业之一。

## **(二) 扩大业务规模的必要性，新增产能规模的合理性**

### **1、扩大业务规模的必要性**

**(1) 扩充“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”产能，提升公司市场竞争力，助力我国人工智能、云计算、物联网、5G、新能源汽车、自动驾驶、高端装备等下游战略新兴行业的发展**

随着全球集成电路产业贸易冲突的加剧，集成电路测试的自主可控和国产化成为行业内企业的共同诉求。本次无锡和南京两个测试基地项目的建设，主要购置“高端芯片测试”及“高可靠性测试”所需的爱德万 V93000 EXA、爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex、老化测试设备、三温探针台、三温分选机等，大幅扩充“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的测试产能，缓解我国“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”相对紧张的局面，为我国集成电路测试的自主可控提供有力保障，最终助力我国人工智能、云计算、物联网、5G、新能源汽车、自动驾驶、高端装备等下游战略新兴行业的发展。

**(2) 为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司的行业地位，强化“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的差异化竞争优势，不断缩小与国际巨头的差距，并在部分高端设备方面首次实现同台竞技**

自 2016 年成立以来，公司经营业绩实现了高速增长，截至目前，公司已经发展成为第三方集成电路测试领域规模最大的内资企业之一。随着业务量不断上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行业具有“大者恒大”的规律，通过本次无锡和南京 2 个测试基地项目的建设，能够进一步巩固公司的行业地位，强化公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的差异化竞争优势，为公司把握国产化的历史机遇及新一轮行业上行周期的增长机会奠定基础。

本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增加公司的测试服务能力、营业

收入和净利润规模，不断缩小公司与全球最大的 3 家台资巨头的差距。同时，本次募投项目购置的泰瑞达 UltraFlex Plus 等部分高端测试设备系首批引入中国大陆，使公司在部分高端设备方面首次实现与国际巨头同台竞技。

## 2、产能规划的合理性

### (1) 公司扩产规模相比市场规模较小，预计产能消化不存在障碍

我国集成电路测试行业市场空间广阔且增长迅速。据 Gartner 咨询和法国里昂证券预测，未来集成电路测试行业仍将保持两位数的增长速度，2027 年中国大陆测试服务市场将达到 740 亿元。公司两个募投项目达到预定可使用状态后预计每年给公司带来 6.45 亿元收入增长，而 2027 年国内测试市场容量则已超过 700 亿元水平。公司扩产规模相比市场规模较小，产能规划合理。

### (2) 公司历史增速较高，2024 年有望重回高速增长轨道，为募投项目产能消化奠定了坚实基础

公司是第三方集成电路测试行业成长性较为突出的企业之一。2019 年-2022 年公司营业收入增长率分别为 78.38%、106.84%、205.93%和 48.64%。2023 年受行业周期下行的影响，公司营业收入仅增长 0.48%，但是从季度数据来看，经过 2023 年一二季度的低位盘整，2023 年三四季度公司重拾增长态势，营业收入相继创出单季度历史新高。2024 年经过一季度传统淡季，二季度的单季度营业收入再次创出历史新高。2024 年上半年公司营业收入同比增长 37.85%，从过去一年的发展趋势来看，公司营业收入有望在 2024 年重回高速增长轨道，从而为募投项目产能消化奠定了坚实基础。

### (3) 公司未来发展空间和潜力较大，为募投项目产能消化提供了充足空间

虽然公司已经成为第三方集成电路测试领域规模最大的内资企业之一，但是 2023 年公司销售收入仅有 7.37 亿元，仅为中国大陆集成电路测试市场规模的 2%左右，仅相当于全球巨头京元电子销售规模的 10%，全年产能尚不能满足一家百亿收入规模级别的头部芯片设计公司一年的全部测试需求。因此，无论从市场占有率、与国际巨头的差距、公司销售占下游客户采购总额的比重等角度来看，公司仍然具有较大的发展空间和潜力，为募投产能消化提供了充足空间。

综上，公司本次产能规划具有合理性。

#### 四、本次募集资金投资项目的具体情况

##### （一）伟测半导体无锡集成电路测试基地项目（无锡项目）

##### 1、项目概况

“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”的实施主体为全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司，总投资额为 98,740 万元，拟使用本次募集资金金额为 70,000 万元。本项目在无锡购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”相关机台，提升公司在上述两个方向的服务能力。

##### 2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”的投资总额为 98,740.00 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	是否属于资本性支出
一	<b>建设投资</b>	<b>97,740.00</b>	<b>69,000.00</b>	是
1	土地及基础设施建设费用	27,888.92	25,800.00	是
2	工程建设及其他费用	1,250.00	100.00	是
3	设备购置费	67,038.00	42,000.00	是
4	预备费	1,563.08	1,100.00	否
二	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	否
	<b>合计</b>	<b>98,740.00</b>	<b>70,000.00</b>	

##### （1）土地及基础设施建设费用

土地及基础设施建设包括相关土地使用权的出让金、厂房土建和土方工程等，具体金额根据预计项目建设工程量及项目地工程造价水平估计。根据公司签订的土地出让合同，本次土地出让金为 1,935.55 万元；根据公司进行的前期实地调研情况，预估本次厂房土建金额为 11,500.00 万元，土方工程金额 500.00 万元，装修费用 13,953.37 万元，合计本次建筑工程费约为 27,888.92 万元。

##### （2）工程建设及其他费用

工程建设其它费用主要包括本项目实施过程中产生的设计评审费和市政设施基础配套费等费用，主要依据公司历史建设项目的费用情况进行估算，并结合本项目实际情况确定，预计为 1,250.00 万元。

### (3) 设备购置费

本项目设备测算主要参考公司历史设备采购价格，预计设备购置费 67,038.00 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额（万元）
测试机	100	52,294.00
探针台	50	4,800.00
分选机	50	6,300.00
其他设备	20	3,644.00
<b>合计</b>	<b>220</b>	<b>67,038.00</b>

### (4) 预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。根据项目的实际情况，预估本项目预备费为 1,563.08 万元，占工程建设及设备购置费用的 1.60%。

### (5) 铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

## 3、项目实施进度

本次募投项目计划建设期 5 年，将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度，具体实施进度如下表所示：

项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年				T+4 年				T+5 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4																
土地购买																				
厂房土建和装修																				
设备采购及安装调试																				
人员招聘及培训																				
产品技术及开发																				

项目	T+1年				T+2年				T+3年				T+4年				T+5年			
	Q1	Q2	Q3	Q4																
生产																				

注：T为项目开工建设时点，Q代表季度

## （二）伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目（南京项目）

### 1、项目概况

“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”的实施主体为全资子公司南京伟测半导体科技有限公司，总投资额为 90,000 万元，拟使用募集资金投资额为 20,000 万元。本项目在南京购置土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置“高端芯片测试”及“高可靠性芯片测试”相关机台，提升公司在上述两个方向的服务能力。

### 2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”的投资总额为 90,000.00 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	是否属于资本性支出
一	<b>建设投资</b>	<b>89,000.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>是</b>
1	土地及基础设施建设费用	26,767.31	4,600.00	是
2	工程建设及其他费用	1,383.07	300.00	是
3	设备购置费	60,305.38	14,200.00	是
4	预备费	544.24	300.00	否
二	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>否</b>
	<b>合计</b>	<b>90,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>

#### （1）土地及基础设施建设费用

本项目建筑内容包括相关土地使用权的出让金、土建工程、土方工程、桩基工程及装修费用等，具体金额根据预计项目建设工程量及项目地工程造价水平估计。根据公司签订的土地出让合同，本次土地出让金为 1,098.54 万元，根据公司签订的相关建设合同及实际采购情况，预计本次厂房土建金额为 9,990.00 万元，土方工程金额为 495.00 万元，桩基工程金额为 1,325.25 万元，装修费用 13,858.52 万元，合计本次土地及基础设施建设费用约为 26,767.31 万

元。

### (2) 工程建设及其他费用

工程建设其它费用主要包括在本项目实施过程中产生的设计评审费和市政设施基础配套费等费用，主要依据公司历史建设项目的费用情况进行估算，并结合本项目实际情况确定，预计为 1,383.07 万元。

### (3) 设备购置费

本项目设备测算主要参考公司历史设备采购价格，预计设备购置费 60,305.38 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额（万元）
测试机	90	49,811.00
探针台	50	4,200.00
分选机	40	4,590.00
其他设备	10	1,704.38
<b>合计</b>	<b>190</b>	<b>60,305.38</b>

### (4) 预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。根据项目的实际情况，本项目预备费为 544.24 万元，占工程建设及设备购置费用的 0.61%。

### (5) 铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

## 3、项目实施进度

本次募投项目计划建设期 3 年，将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度，具体实施进度如下表所示：

项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土地购买												
厂房土建和装修												
设备采购及安装调试												

项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
人员招聘及培训												
产品技术及开发												
生产												

注：T 为项目开工建设时点，Q 代表季度

### （三）偿还银行贷款及补充流动资金

#### 1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 27,500 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，占预计募集资金总额的 23.40%。

#### 2、项目必要性及规模的合理性

##### （1）项目实施的必要性

截至 2024 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 4,053.25 万元，长期借款余额为 84,994.32 万元，一年内到期的非流动负债余额为 15,531.89 万元，有息负债总额超过 10 亿元，偿债压力较大。此外，随着公司经营规模的稳步扩张，所需营运资金规模将不断增加。因此，本次偿还银行贷款及补充流动资金能有效缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，解决公司发展过程中的资金需求问题，优化资本结构、减轻财务负担，进一步提高公司抗风险能力和公司综合竞争力，为提升持续盈利能力提供保障。

##### （2）项目实施的可行性

##### ①公司内控完善，募集资金管理相关制度规范

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专项储存、使用作出了明确的制度安排，以在制度上保证募集资金的规范使用。

②本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合法律法规的规定

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。本次发行可转换公司债券偿还银行贷款及补充流动资金的总金额为 27,500 万元。除此以外，本次募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”中包含 3,000 万元预备费及铺底流动资金，属于非资本性支出。上述金额合计占募集资金总额的比例为 25.96%，未超过 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

## 五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

### （一）实施能力

公司主要从事晶圆测试和芯片成品测试，形成了具有自主知识产权的核心技术体系，具备较强的核心技术优势、研发能力优势、人才优势、客户优势等，实施本次募投项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。

#### 1、本次投资项目的下游市场容量大、增速高，为项目的实施提供了市场保障

本次募投项目投资于“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”两个方向，“高端芯片测试”优先服务于高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）的测试需求，“高可靠性芯片测试”优先服务于车规级芯片、工业级芯片的测试需求。上述芯片主要应用于各类旗舰级终端产品、人工智能、云计算、物联网、5G、新能源电动车、自动驾驶、智能装备等领域，代表着未来的科技和消费发展方向，具有市场容量大、增速高的特点，为项目的实施提供了市场保障。

#### 2、公司拥有经验丰富、专业能力过硬的经营和技术团队，为项目的实施提供了人才保障

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”有着丰富的实践

经验和技術积累，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力，为本项目的实施提供了人才保障。

**3、公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”具有多年成功经验，积累了一大批高质量的客户，为本次项目的实施提供了客户保障**

在高端芯片测试领域，公司自 2018 年以来开始大力引进高端测试机台，将经营重心向高端测试和高端客户倾斜，2023 年度高端测试占公司业务收入的比例超过 75%，公司已经成为中国大陆高端测试服务的主要供应商之一，服务的客户包括客户 A、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、比特大陆、复旦微电、安路科技、瑞芯微等一大批知名厂商。

在高可靠性芯片测试领域，公司较早地大规模引进了国内相对稀缺的三温测试设备，并于 2021 年底在无锡筹备建立专业的老化测试生产线。公司在高可靠性芯片测试领域的技术实力、装备优势获得了大量车规级、工业级客户的认可，服务的客户包括地平线、合肥智芯、兆易创新、中兴微电子、复旦微电、国芯科技、杰发科技、禾赛科技、芯驰科技等一大批知名厂商。

综上，公司在“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”具有多年成功经验，积累了一大批高质量的客户，能够为本次项目的实施提供客户保障。

## **（二）资金缺口的解决方式**

本次募集资金投资项目总投资额为 188,740.00 万元（不含偿还银行贷款及补充流动资金金额），拟使用 IPO 超募资金 63,347.49 万元和本次募集资金 90,000.00 万元，剩余资金拟通过自有资金或自筹资金解决。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## **六、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程**

### **（一）伟测半导体无锡集成电路测试基地项目（无锡项目）**

#### **1、主要假设条件**

假设宏观经济环境和半导体行业市场情况及公司经营情况不会发生重大不利变化，本次募投项目的主要假设条件如下：

(1) 本项目的计算期为 10 年；

(2) 公司设备分四批采购，每年采购总设备数量的四分之一。第一批采购的测试设备于 T+2 年开始投产，第二批采购的测试设备于 T+3 年开始投产，第三批采购的测试设备于 T+4 年开始投产，第四批采购的测试设备于 T+5 年开始投产。考虑设备逐步释放产能及设备可能出现的维修调整等情况，每批设备第一年的年销售产能以该批设备满产产能的 20%，第二年的年销售产能以该批设备满产产能的 70%，第三年及以后的年销售产能以该批设备满产产能的 90% 进行估算。

## 2、主要计算过程

### (1) 营业收入预计

营业收入的测算系根据各测试平台测试时长和测试单价测算，即营业收入=测试时长×测试单价。其中测试时长为 24 小时\*360 天\*90%，考虑到测试平台在运转过程中存在检修、维护等因素，故测试时长以全年时长的 90% 计算。考虑设备可能出现维修等意外情况，完全达产年度后的销售产能以满产产能的 90% 作为审慎估计值。测试单价系参考公司近期同类型测试平台平均销售单价及市场情况进行的预估。项目建成后，达产年的销售收入为 33,242.40 万元，具体情况如下：

产品类型	稳定运营期销售收入（万元）
高端测试平台	29,323.30
中端测试平台	3,919.10
<b>合计</b>	<b>33,242.40</b>

### (2) 总成本费用测算

本次募投项目的总成本费用包括营业成本、销售费用、管理费用、研发费用等。参考发行人历史水平并结合项目公司实际经营情况予以确定。

其中，营业成本包括设备折旧及摊销、直接人工、制造费用和能源费用等，具体情况如下：

①折旧及摊销：折旧摊销包含生产厂房与机器设备折旧及土地使用权摊销。本建设项目使用年限平均法，房屋建筑物按 20 年折旧，残值率 0%；生产设备

按 10 年折旧，残值率 0%；土地使用权按 30 年摊销，无残值，摊销年限与土地出让合同中的使用年限一致。

②直接人工：参考公司实际情况预估生产制造中的员工数量和平均薪酬。

③制造费用及能源费用：依据公司历史水平进行测算。

④销售费用、管理费用、研发费用：根据公司历史水平并结合公司实际经营情况进行测算。

### （3）税金及附加

增值税进销项税率为 13%，城市建设费和教育附加（含地方教育附加）分别为 7%和 5%。

### （4）所得税测算

按照企业所得税率为 15%。

### （5）项目效益总体情况

根据方案测算，本项目具有较强的盈利能力。本项目完全达产后年平均销售收入 33,242.40 万元，项目财务内部收益率 16.43%，静态投资回收期为 8.94 年。项目具体效益情况如下：

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	营业收入	-	1,846.80	8,310.60	16,621.20	24,931.80
2	毛利率	-	-67.61%	10.18%	33.14%	40.65%
3	利润总额	-38.71	-1,627.89	-869.68	2,087.75	5,004.58
4	净利润	-38.71	-1,617.44	-822.73	1,854.52	4,373.78
序号	项目	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
1	营业收入	30,780.00	33,242.40	33,242.40	33,242.40	33,242.40
2	毛利率	49.25%	51.77%	51.42%	51.06%	50.69%
3	利润总额	8,823.98	10,365.55	10,249.54	10,130.05	10,006.97
4	净利润	7,500.38	8,810.72	8,712.11	8,610.54	8,505.92

## （二）伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目（南京项目）

### 1、主要假设条件

假设宏观经济环境和半导体行业市场情况及公司经营情况不会发生重大不利变化，本次募投项目的主要假设条件如下：

（1）本项目的计算期为 10 年；

（2）公司设备分三批采购，每年采购总设备数量的三分之一。第一批采购的测试设备于 T+1 年开始投产，第二批采购的测试设备于 T+2 年开始投产，第三批采购的测试设备于 T+3 年开始投产。考虑设备逐步释放产能及设备可能出现的维修调整等情况，每批设备第一年的年销售产能以该批设备满产产能的 20%，第二年的年销售产能以该批设备满产产能的 70%，第三年及以后的年销售产能以该批设备满产产能的 90%进行估算。

### 2、主要计算过程

#### （1）营业收入预计

营业收入的测算系根据各测试平台测试时长和测试单价测算，即营业收入=测试时长×测试单价。其中测试时长为 24 小时\*360 天\*90%，考虑到测试平台在运转过程中存在检修、维护等因素，故测试时长以全年时长的 90%计算。考虑设备可能出现维修等意外情况，完全达产年度后的销售产能以满产产能的 90%作为审慎估计值。测试单价系参考公司近期同类型测试平台平均销售单价及市场情况进行的预估。项目建成后，达产年的销售收入为 31,282.85 万元，具体情况如下：

产品类型	稳定运营期销售收入（万元）
高端测试平台	29,295.30
中端测试平台	1,987.55
合计	<b>31,282.85</b>

#### （2）总成本费用测算

本次募投项目的总成本费用包括营业成本、销售费用、管理费用、研发费用等。参考发行人历史水平并结合项目公司实际经营情况予以确定。

其中，营业成本包括设备折旧及摊销、直接人工、制造费用和能源费用等，

具体情况如下：

①折旧及摊销：折旧摊销包含生产厂房与机器设备折旧及土地使用权摊销。本建设项目使用年限平均法。房屋建筑物按 20 年折旧，残值率 0%；生产设备按 10 年折旧，残值率 0%；土地使用权按 50 年摊销，无残值，摊销年限与土地出让合同中的使用年限一致。

②直接人工：参考公司实际情况预估生产制造中的员工数量和平均薪酬。

③制造费用及能源费用：依据公司历史水平进行测算。

④管理费用、研发费用、销售费用：根据公司历史水平并结合公司实际经营情况进行测算。

### （3）税金及附加

增值税进销项税率为 13%，城市建设费和教育附加（含地方教育附加）分别为 7%和 5%。

### （4）所得税测算

企业所得税率为 15%。

### （5）项目效益总体情况

根据方案测算，本项目具有较强的盈利能力。本项目完全达产后年平均销售收入 31,282.85 万元，项目财务内部收益率 17.33%，静态投资回收期为 7.19 年。项目具体效益情况如下：

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	营业收入	2,317.25	10,427.62	20,855.23	28,965.60	31,282.85
2	毛利率	-66.36%	18.12%	38.47%	51.98%	54.35%
3	利润总额	-2,013.65	-263.87	3,679.64	9,093.06	10,561.29
4	净利润	-2,013.65	-263.87	3,127.70	7,729.10	8,977.09
序号	项目	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10
1	营业收入	31,282.85	31,282.85	31,282.85	31,282.85	31,282.85
2	毛利率	54.05%	53.75%	53.45%	53.13%	52.80%
3	利润总额	10,470.16	10,376.30	10,279.62	10,180.04	10,077.48

4	净利润	8,899.64	8,819.85	8,737.68	8,653.04	8,565.86
---	-----	----------	----------	----------	----------	----------

### （三）补充流动资金及偿还银行贷款

#### 1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 27,500.00 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

#### 2、项目必要性及规模的合理性

截至 2024 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 4,053.25 万元，长期借款余额为 84,994.32 万元，一年内到期的非流动负债余额为 15,531.89 万元，有息负债总额超过 10 亿元，偿债压力较大。此外，随着公司经营规模的稳步扩张，所需营运资金规模将不断增加。因此，本次偿还银行贷款及补充流动资金能有效缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，解决公司发展过程中的资金需求问题，优化资本结构、减轻财务负担，进一步提高公司抗风险能力和公司综合竞争力，为提升持续盈利能力提供保障。

## 七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

### （一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

本次募集资金均用于公司主营业务集成电路测试领域。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），本次募投项目所属领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域，属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，本次募投项目所属领域属于第五条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。

因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

### （二）募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式

通过本次募投项目的实施，公司将进一步实现集成电路测试尤其是高端测试产能的扩张，进一步提升公司测试方案的开发能力，提高公司核心技术水平

和产品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的持续提升。

未来公司将持续加大研发投入，重点针对车规级、工业类及高算力、复杂的 SoC 芯片的测试、大数据处理等方向，着重突破各类高端芯片的测试难点，为公司持续发展注入新动能。

## 八、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

本次募投项目涉及有关审批、批准或备案事项具体情况如下：

项目名称	立项	土地	环保审批
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	已取得无锡市新吴区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡新行审投备〔2023〕774号）	已取得《不动产权证书》（苏〔2022〕无锡市不动产权第0209910号）	已取得无锡市行政审批局出具的《关于无锡伟测半导体科技有限公司伟测半导体无锡集成电路测试基地环境影响报告表的批复》（批复号锡行审环许〔2024〕7056号）
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	已取得南京市浦口区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（浦行审备〔2022〕218号）	已取得《不动产权证书》（苏〔2023〕宁浦不动产权第0012432号）	已取得南京市生态环境局出具的《关于伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目环境影响报告表的批复》（宁环建〔告〕〔2022〕0803号）
偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用

截至本募集说明书签署日，本次募投项目不存在其他尚未履行完毕的立项、土地、环保等审批、批准或备案事项。

## 第六节 备查文件

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- 二、保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书和律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级报告；
- 六、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》之签章页）



上海伟测半导体科技股份有限公司

2025年4月7日